

股票简称：汇成股份

股票代码：688403

# 合肥新汇成微电子股份有限公司

Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.

(合肥市新站区合肥综合保税区内)



## 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路 689 号)

二〇二四年八月

## 声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书摘要正文内容，并特别关注以下重要事项。

### 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

### 二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

### 三、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。

本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

### 四、本次发行不提供担保

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。

### 五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

#### （一）市场竞争加剧及公司综合竞争力相对行业头部企业较小的风险

近年来，集成电路封装测试行业竞争日趋激烈，显示驱动芯片封测领域资本不断涌入。一方面，境内行业龙头企业不断拓展产品线，如通富微电2017年立项研究12吋晶圆金凸块制造技术，进军显示驱动芯片封测领域。另一方面，外资与合资封装测试企业进一步布局中国境内市场，如深圳同兴达科技股份有限公司与日月光半导体（昆山）有限公司合作的“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”已经逐步实施。

相比显示驱动芯片封测行业头部企业颀邦科技、南茂科技等，公司业务规模仍存在较大差距。公司起步较晚，受资金、规模等方面的限制，综合竞争力亟待提升。在业务快速扩张的过程中，如果公司不能很好地应对同行业龙头企业竞争中的规模优势，将可能导致公司业务发展受阻；此外，境内外龙头企业的双重竞争态势愈发激烈，市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击。

## （二）区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内主要生产设备和部分原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在60%以上。

如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、单位成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

## （三）毛利率波动及下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为30.63%、30.18%和27.17%，2023年毛利率相较于2022年度有所下降，主要系2022年下半年至2023年第一季度，公司产品终端应用市场消费需求有所下滑，销售单价有所降低，而订单饱和度有所下降，单位固定成本有所上升导致。如果未来受显示面板产业周期波动影响，或国家产业政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力水平若无法适应未来发展，造成人力成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者公司研发未来受限于资金规模，不能持续有效地实施业务发展规划，保持技术与服务的领先性，提供高附加值服务，均可能导致公司毛利率面临进一步下滑的风险。

## （四）客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的主营业务收入合计分别为56,284.51万元、70,531.76万元和89,078.78万元，占当期主营业务收入的比例为73.48%、79.75%和76.24%，客户集中度较高。如果未来公司的主要客户生产经营出现问题，导致其向公司下达的订单数量下降，或公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

## （五）供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大原材料供应商采购额合计为28,053.53万元、30,939.63万元和39,853.89万元，占当期原材料采购总额的比例为83.79%、83.07%

和80.32%，供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

#### （六）实际控制人借款金额较大，存在影响公司实际控制人稳定性的风险

公司所处行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，公司实际控制人郑瑞俊为支持公司发展、为员工持股平台支付增资款以吸引优秀人才和维持团队稳定，以及受让股东持有的部分股权，资金需求较大，存在以个人名义对外借款的情形。截至2024年5月13日，公司实际控制人郑瑞俊存在多项未到期的大额负债，借款本金超过3亿元，负债到期时间为2025年1月至2026年9月不等。如实际控制人不能按期偿还借款，则届时实际控制人持有的公司股份可能被债权人要求冻结、处置，存在对公司实际控制人稳定性造成不利影响的风险。

#### （七）本次募集资金投资项目未达预期效益的风险

本次募集资金投资主要投向12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目和12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目，募集资金投资项目的实施计划、实施进度主要根据发行人及行业过往建设经验确定，项目预计效益主要根据可行性研究报告编制时点的市场销售价格、历史经验以及未来预测市场情况等测算得出，综合考虑了市场环境、行业发展趋势等各种因素。若项目建设过程中出现项目管理和实施等方面的不可预见风险，或项目建成后市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、下游需求不及预期、原材料成本上升等情形，则可能导致本次募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

#### （八）本次募投项目与前次募投项目新增折旧摊销对公司经营业绩带来的风险

本次募集资金投资项目全部建成后，发行人将新增大量固定资产，项目投入运营后，正常年度每年预计新增折旧摊销金额为10,247.86万元，公司本次募投项目与前次募投项目新增折旧摊销金额对公司经营业绩的影响情况如下：

单位：万元

项目	前次募投项目	本次募投项目	合计
折旧摊销金额①	8,115.70 <sup>注</sup>	10,247.86	18,363.56

本次募投项目预计新增收入②	45,142.44
公司 2023 年度收入③	123,829.30
占 2023 年度收入及募投项目预计新增收入之和的比例④=①/ (②+③)	10.87%
本次募投项目预计新增息税折旧摊销前利润⑤	20,265.78
公司 2023 年度息税折旧摊销前利润⑥	47,730.24
占 2023 年度利润总额及募投项目预计新增利润总额之和的比例⑦=①/ (⑤+⑥)	27.01%

注：截至 2023 年 12 月末，公司前次募投项目已实施完毕，为充分反映前次募投项目折旧摊销金额对公司经营业绩的影响，上表中前次募投项目折旧摊销金额系根据 2023 年 12 月前次募投项目折旧摊销金额年化计算，即 2023 年 12 月前次募投项目折旧摊销金额\*12。

如上表所示，公司前次募投项目和本次募投项目折旧摊销合计金额占 2023 年度收入及募投项目预计新增收入之和的比例为 10.87%，占 2023 年度息税折旧摊销前利润及募投项目预计新增息税折旧摊销前利润之和的比例为 27.01%。由于项目从开始建设到产生效益需要一段时间，且影响募集资金投资效益实现的因素较多，如果未来市场环境发生重大不利变化或者项目经营管理不善，使得项目在投产后实际效益低于预期或晚于预期，则公司仍存在因折旧摊销费用增加而导致利润下滑的风险。

## （九）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险

### 1、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对公司生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

### 2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

## 六、关于填补即期回报的措施和承诺

### （一）应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在公司即期回报被摊薄的风险。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。具体措施如下：

#### 1、严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

#### 2、稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益

本次募集资金将用于公司 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目和 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目。本次发行可转债募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场占有率，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，提高公司经营业绩和盈利能力，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

#### 3、完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权并作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。



#### 4、完善利润分配政策，重视投资者回报

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

### （二）应对本次发行摊薄即期回报的相关承诺

#### 1、公司控股股东出具的相关承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东扬州新瑞连承诺：

“1、本承诺人承诺将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本承诺人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

3、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

4、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺；

5、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。”

## 2、公司实际控制人出具的相关承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人郑瑞俊、杨会承诺：

“1、本承诺人承诺将忠实、勤勉地履行作为实际控制人的职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本承诺人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

3、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

4、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺；

5、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。”

## 3、公司董事、高级管理人员出具的相关承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺：

“1、本承诺人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

2、本承诺人承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束；

3、本承诺人承诺不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本承诺人承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要

求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度；

5、本承诺人承诺如公司未来实施新的股权激励方案，应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

7、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺；

8、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。”

请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读募集说明书中“第三节 风险因素”等有关章节。

## 目 录

声 明.....	2
重大事项提示 .....	3
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险.....	3
二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明.....	3
三、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	4
四、本次发行不提供担保.....	4
五、特别风险提示.....	4
六、关于填补即期回报的措施和承诺.....	8
目 录.....	12
第一节 释义 .....	14
第二节 本次发行概况 .....	18
一、发行人基本情况.....	18
二、本次发行的背景和目的.....	18
三、本次发行概况.....	21
四、本次发行可转债的基本条款.....	25
五、本次发行的有关机构.....	36
六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.....	38
第三节 发行人基本情况 .....	39
一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况.....	39
二、公司控股股东、实际控制人基本情况.....	40
第四节 财务会计信息与管理层分析 .....	43
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平.....	43
二、发行人财务报表.....	43
三、财务报表的编制基础.....	47
四、合并财务报表范围及变化情况.....	48
五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	48
六、报告期内会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正.....	51

七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策.....	52
八、财务状况分析.....	54
九、盈利能力分析.....	76
十、现金流量分析.....	93
十一、资本性支出分析.....	96
十二、技术创新分析.....	97
十三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响.....	99
十四、本次发行的影响.....	99
<b>第五节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>101</b>
一、本次募集资金使用计划.....	101
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....	101
三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	112
四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性.....	113
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	115
<b>第六节 备查文件 .....</b>	<b>117</b>

## 第一节 释义

本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通名词释义		
公司、本公司、发行人、汇成股份	指	合肥新汇成微电子股份有限公司
江苏汇成	指	江苏汇成光电有限公司，发行人全资子公司
晶汇聚芯	指	合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙），发行人参股公司
晶合汇信	指	合肥晶合汇信私募基金管理有限公司，发行人参股公司
扬州新瑞连	指	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙），发行人控股股东
香港宝信	指	宝信国际投资有限公司，一家中国香港公司，员工持股平台
合肥芯成	指	合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
合肥汇芯	指	合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
合肥宝芯	指	合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
汇成投资	指	汇成投资控股有限公司，发行人股东
嘉兴高和	指	嘉兴高和股权创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，原名为嘉兴高和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
志道投资	指	安徽志道投资有限公司，发行人股东
海通新动能	指	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
海通新能源	指	海通新能源私募股权投资管理有限公司，海通新动能执行事务合伙人
海通开元	指	海通开元投资有限公司，海通证券全资子公司，海通新能源股东
瑞成建筑	指	瑞成建筑工程（安徽）有限公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
瑞成投资	指	瑞成投资控股有限公司，一家中国香港公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
百瑞发投资	指	百瑞发投资股份有限公司，一家中国台湾公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
天虹科技	指	天虹科技股份有限公司，股票代码：6937.TWO
蔚华电子	指	蔚华电子科技（上海）有限公司，发行人股东
Advance	指	Advance Allied Limited，一家塞舌尔公司，发行人股东
Great Title	指	Great Title Limited，一家 BVI 公司，发行人股东
天钰科技	指	天钰科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：4961.TW，发行人客户
联咏科技	指	联咏科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码为：3034.TW，发行人客户
奇景光电	指	Himax Technologies Inc，奇景光电股份有限公司，美股上市公司，股票代码为：HIMX.O，发行人客户
瑞鼎科技	指	瑞鼎科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：

		3592.TWO, 发行人客户
矽创电子	指	矽创电子股份有限公司, 中国台湾上市公司, 股票代码: 8016.TW, 发行人客户
奕力科技	指	奕力科技股份有限公司, 知名显示驱动芯片设计公司, 发行人客户
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司, 知名显示驱动芯片设计公司, 发行人客户
爱协生	指	深圳市爱协生科技股份有限公司, 知名显示驱动芯片设计公司, 发行人客户
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 000725.SZ, 知名面板厂商
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 002387.SZ, 知名面板厂商
友达光电	指	友达光电股份有限公司, 中国台湾上市公司, 股票代码: 2409.TW, 知名面板厂商
日月光	指	日月光投资控股股份有限公司, 中国台湾上市公司, 股票代码: 3711.TW
Amkor	指	Amkor Technology Inc, 安靠科技, 美股上市公司, 股票代码: AMKR.O
顾邦科技	指	顾邦科技股份有限公司, 中国台湾上市公司, 股票代码: 6147.TWO
南茂科技	指	南茂科技股份有限公司, 中国台湾上市公司, 股票代码: 8150.TW
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 600584.SH
通富微电	指	通富微电子股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 002156.SZ
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 002185.SZ
晶方科技	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 603005.SH
利扬芯片	指	广东利扬芯片测试股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 688135.SH
气派科技	指	气派科技股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 688216.SH
顾中科技	指	合肥顾中科技股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 688352.SH
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司, A 股上市公司, 股票代码: 688249.SH, 知名晶圆制造厂商, 位于合肥市综合保税区, 主要从事面板显示驱动芯片的晶圆代工
Frost & Sullivan	指	弗若斯特沙利文公司, 成立于 1961 年, 总部位于美国纽约, 是一家独立的国际咨询公司, 在全球设立 45 个办公室, 拥有超过 2,000 名咨询顾问, 为多家全球 1,000 强公司、新兴企业和投资机构提供了市场投融资及战略与管理咨询服务
保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司, 发行人保荐机构
发行人律师	指	安徽天禾律师事务所, 发行人律师
天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙), 发行人会计师
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2021 年、2022 年及 2023 年

可转债	指	可转换公司债券
本次发行、本期可转债	指	本次发行人向不特定对象发行可转换公司债券
本募集说明书摘要	指	《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
<b>二、专业术语释义</b>		
吋	指	英寸的缩写，一吋等于 2.54 厘米
Bumping	指	在芯片上制作凸块，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，反应了先进制程“以点代线”的发展趋势，广泛应用于 FC、WLP、CSP、3D 等先进封装
Gold Bumping	指	金凸块制造，是一种利用金凸块接合替代引线键合实现芯片与基板之间电气互联的制造技术
CP	指	Chip Probing 的缩写，即晶圆测试，是一道用探针对每个晶粒上的接点进行接触测试其电气特性，标记出不合格的晶粒的工序
COG	指	Chip on Glass 的缩写，即玻璃覆晶封装，是一种将芯片直接绑定在玻璃上的封装技术
COF	指	Chip on Film/Flex 的缩写，即薄膜覆晶封装，是一种将芯片绑定在软性基板电路上的封装技术
引脚	指	集成电路内部电路与外围电路的接线
探针	指	一种测试接口，通过电气连接对芯片参数进行测试
电镀液	指	可以扩大金属的阴极电流密度范围、改善镀层的外观、增加溶液抗氧化的稳定性等特点的液体
光刻胶	指	在光线照射下，溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料
Tray 盘	指	晶粒盘，是用于承托晶粒（芯片）的托盘
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有机发光二极管，属于一种电流型的有机发光显示技术
FC	指	一种封装技术，FC 系 Flip Chip 的缩写，即倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小
WLP	指	一种封装技术，Wafer Level Packaging 的缩写，即晶圆级封装，一般指直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序，之后再切割（Singulation）制成单颗组件的封装技术
CSP	指	一种封装技术，Chip Size Package 的缩写，即芯片级封装，是最新一代的内存芯片封装技术，可以让芯片面积与封装面积之比超过 1:1.14
3D	指	一种封装技术，三维立体封装，是在 2D 的基础上进一步向 Z 方向发展的微电子组装高密度化封装形式，主要有埋置型、有源基板型与叠层型三种类型
牛鞭效应	指	营销过程中的需求变异放大现象被通俗地称为“牛鞭效应”，指供应链上的信息流从最终客户向原始供应商端传递时候，由于无



		法有效地实现信息的共享，使得信息扭曲而逐渐放大，导致了需求信息出现越来越大的波动
--	--	--

本募集说明书摘要中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

## 第二节 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

公司名称	合肥新汇成微电子股份有限公司
英文名称	Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
股本总额	83,485.3281 万元
股票代码	688403
股票简称	汇成股份
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	郑瑞俊
有限公司成立日期	2015 年 12 月 18 日
股份公司成立日期	2021 年 3 月 30 日
上市日期	2022 年 8 月 18 日
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内

### 二、本次发行的背景和目的

#### (一) 本次发行的背景

##### 1、公司具备先进且成熟的制程工艺，为项目建设提供了保障

显示驱动芯片封装测试行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，需要企业具备丰富的生产加工经验。近年来，OLED 显示驱动芯片不断应用于高端电子消费产品和新能源汽车上，下游厂商对于 OLED 显示驱动芯片的品质要求越来越高，且集成电路设计和制造业技术不断进步，加快了各种封装技术和工艺水平的更新进步周期，需要企业不断进行创新和改进技术水平。

汇成股份长期专注于显示驱动芯片封装测试的研究开发和产业化应用，针对显示驱动芯片封装测试过程中的具体工艺或生产装置进行技术研发，自主研发积累了大量工艺技术，在行业内具有领先地位。公司的核心技术包括驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术、高精度高效内引脚接合工艺等，特别是金凸块制造技术以黄金作为材料，具有出色的导电性、机械加工性以及散热性能，可满足显示面板驱动的使用要求。本次募投项目各制程主要采用公司成熟的工艺，可快速部署投入生产，保障项目顺利实施。

## 2、公司具备扎实的客户合作基础，为项目建设提供了良好基础

集成电路设计与制造行业具有技术和资本密集特点，行业集中度较高。基于对产品良率和成本的考量，封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认证后才能达成长期合作，故存在较高的供应链门槛。公司凭借稳定的产品良率、全流程的生产服务能力和交付能力获得了行业内知名客户的广泛认可，公司所封测的显示驱动芯片也被应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，服务能力被各方合作企业所信赖。公司的下游客户覆盖了全球排名前五和国内排名前十显示驱动芯片设计公司中的主要企业，包括联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等知名显示驱动芯片设计企业，具备良好的客户合作基础，能够为本次募投项目的投产运营提供市场支持。综上所述，广泛的客户资源和良好的客户认可度，为公司的业务承接和业务推广提供了帮助，有助于本次募投项目建成后的产能消化。

## 3、广阔的市场前景为项目的实施提供了保障

随着社会经济和科学技术的发展，显示驱动产品不仅仅应用于智能手机、电脑、电视等电子产品，智能家居的兴起使得智能冰箱、空调、家居中控也都采用显示屏作为智能交互系统。同时，由于新能源汽车的智能驾驶、智慧座舱理念的推广，车载用屏尺寸和数量持续上升，车载显示市场需求快速增长。根据 Frost & Sullivan 分析，由于晶圆产能供给紧张，显示驱动芯片的产量不足，将持续推高销售价格，因此显示驱动芯片封测市场规模也将随之上涨，预计在 2025 年达到 56.10 亿美元。在显示驱动芯片封测市场需求量持续走高的情况下，下游市场能够快速消化本次募投项目新增的产能，为本次募投项目的运营提供保障。

### （二）本次发行的目的

#### 1、顺应行业发展趋势，满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求

公司是国内领先的显示驱动芯片封装测试服务商，制程包括金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装。公司多次开展生产线投资扩产，目前已建成江苏扬州和安徽合肥两大生产基地，由于技术稳定且服务完善，在全球范围内取得了广泛认可。

随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势，消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于 OLED 显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。显示驱动芯片作为 OLED 屏的上游产业，晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨。近年来 OLED 显示屏市场渗透率快速提升，根据 Frost & Sullivan 数据，2020 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达到 14.0 亿颗，预计 2025 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达 24.5 亿颗，市场占比达到 10.5%。

公司作为专业从事于晶圆测试和封装的企业，在显示驱动芯片封测行业深耕多年，具备丰富的产品经验和服 务技术经验。针对市场发展趋势，公司计划扩大在 OLED 领域的产能配置，但是公司当前的设备配置无法满足 OLED 显示驱动芯片需求快速增长的生产需要。为抓住市场机遇，公司计划引进先进高效的生产设备，提升 OLED 产品封装测试能力，满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求，进一步提升公司在显示驱动芯片领域的竞争优势。

## **2、有利于提高规模效益，抢占市场份额，提升公司影响力**

显示驱动芯片封装测试行业技术水平要求较高、资金需求大、人才综合素质门槛高、客户认证严格，因此行业进入壁垒较高，国内可以实现大规模显示驱动芯片封装测试的企业较少。公司在显示驱动芯片封装测试领域从业多年，拥有扎实的核心技术体系和规模生产经验，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。通过本次募投项目的建设，公司的封装测试服务能力进一步加强，扩充了产品生产规模，强化了规模效益，有利于降低服务成本，提高单位产品的盈利能力；另一方面，本次募投项目购置的先进封测设备，能够满足新型 OLED 产品的生产需求，从而公司能够更快地布局 OLED 显示驱动芯片封测市场，抓住 OLED 市场机遇。有助于公司稳固现有客户的同时，进行 OLED 市场的开拓，获取更大的市场份额。

随着我国集成电路产业供应链体系的不断完善，本土显示驱动芯片产业的发展前景广阔。首先，第三代显示技术 OLED 具有能耗低、发光率好、亮度高和轻薄等优点，在终端设备中的应用越来越广泛，国产厂商的产能规模快速扩大。其次，随着智能网联汽车的兴起，座舱系统对显示面板的需求快速增加，有望拉动显示面板行业的增长。本次募投项目建成后，公司将扩大 OLED 面板的显示

驱动封装测试规模，并且拓展车载显示面板市场，扩大国内市场份额，提升公司的品牌影响力。

### **3、有利于满足市场对先进封装测试服务的需要，提高封装测试行业的国产化水平**

随着技术的升级换代，高集成度、低能耗成为电子产品最主要的发展趋势，终端用户对性能体验的要求促进了芯片设计、制造与封装的发展。先进封装测试工艺能够减小芯片占用尺寸、布线长度、厚度等，帮助降低能耗，提高终端用户的屏幕交互体验，促使显示面板厂商会优先采用先进封装测试工艺，因此市场规模快速增长。公司自主开发的金凸块制造技术直接在晶圆上形成焊球或金柱，在此基础上实现了显示驱动芯片的晶圆级高密度细间距倒装封装，有助于开发屏占比高和轻薄化的显示面板，符合整体行业发展趋势。本次募投项目引入先进高效的生产设备后能够提高公司针对 OLED 等新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造和测试服务能力，满足下游客户不断增长的对先进显示驱动芯片封装测试的需求。

目前，我国的液晶显示面板产能占到了全球的 60%以上，但我国芯片产业起步较晚，境外发达国家及地区已经掌握芯片制程的核心技术，并占据了主要芯片市场，因此显示面板上游的芯片制造等高附加值产业大多为境外企业所掌握。在此背景下，境内企业拓展显示面板产品上游产业链，提升产业链上游及中游产品供给能力，实现全流程国产化势在必行。本次募投项目的建设，有助于推动芯片产业链中芯片封测这一环节的建设，强化国产芯片在晶圆封测这一环节的技术能力，使境内产业链整体流转更加畅通，提高行业的国产化水平。

## **三、本次发行概况**

### **（一）本次发行证券的类型**

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

### **（二）发行数量**

本次发行的可转债拟募集资金总额 114,870.00 万元，共计 1,148,700 手（11,487,000 张）。

### （三）证券面值和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （四）预计募集资金量及募集资金净额

本次拟发行可转债的募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含 114,870.00 万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为 114,252.79 万元。

### （五）募集资金专项存储账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会（或董事会授权人士）指定的募集资金专项账户中。

### （六）募集资金投向

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含 114,870.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆凸块制造与晶圆测试扩能项目	47,611.57	35,000.00
2	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	56,099.47	50,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	29,870.00
合计		<b>138,711.04</b>	<b>114,870.00</b>

注：上述拟使用募集资金已扣除公司第一届董事会第十七次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,130.00 万元。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## （七）发行方式与发行对象

本次发行的汇成转债向发行人在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的公司所有 A 股股东。

网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

## （八）向原股东配售的安排

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的汇成股份股份数量按每股配售 1.395 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001395 手可转债。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。

原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本 834,853,281 股，剔除公司回购专户库存股 11,877,470 股后，可参与原股东优先配售的股本总额为 822,975,811 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 1,148,700 手。

### （九）承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 13 日。

### （十）发行费用

项目	金额
保荐及承销费用	350.00 万元
律师费用	75.47 万元
审计费用	75.47 万元
资信评级费用	47.17 万元
用于本次发行的信息披露费用	56.60 万元
发行手续费等	12.49 万元
合计	617.21 万元

注：以上费用均为不含税金额，各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。上述表格数据尾差，系四舍五入所造成。

### （十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行期间的主要日程安排如下：

日期	发行安排
T-2 日 2024 年 8 月 5 日	刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1 日 2024 年 8 月 6 日	网上路演 原股东优先配售股权登记日
T 日 2024 年 8 月 7 日	刊登《发行提示性公告》 原股东优先配售（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率
T+1 日 2024 年 8 月 8 日	刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2 日 2024 年 8 月 9 日	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（须确保资金账户在 T+2 日日终有足够的认购资金）
T+3 日 2024 年 8 月 12 日	保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额



T+4 日 2024 年 8 月 13 日	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户
--------------------------	---------------------------

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

本次申请向不特定对象发行的可转债将在上海证券交易所上市。

## （十二）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。

本次发行的证券不设持有期限限制。

## 四、本次发行可转债的基本条款

### （一）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 8 月 6 日。

### （二）面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （三）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

### （四）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2024 年 8 月 13 日（T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

### （五）评级情况

公司本次发行的可转债已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为 AA-，评级展望稳定。

在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

## （六）债券持有人会议相关事项

### 1、债券持有人的权利与义务

#### （1）债券持有人的权利

- ①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- ②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
- ③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

#### （2）债券持有人的义务

- 遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
- 依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

## 2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更募集说明书的约定；
- (2) 拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
- (3) 拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
- (5) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整或者申请破产；
- (6) 担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
- (7) 债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；
- (8) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- (9) 公司提出重大债务重组方案的；
- (10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (11) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 债券受托管理人；
- (2) 公司董事会；
- (3) 单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
- (4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

### 3、债券持有人会议的表决、决议

(1) 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2) 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

(3) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

(4) 债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。

(5) 会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责

见证表决过程。

(6) 会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

(7) 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

(8) 除本规则另有规定外，债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

(9) 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更发行人与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力外：

①如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力；

②如果该决议是根据发行人的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。

## **（七）转股价格调整的原则及方式**

### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转债的初始转股价格为 7.70 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

## **(八) 转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。转股价格不得向上修正。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **(九) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法**

债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ,并以去尾法取一股的整数倍。其中:Q:指可转换公司债券的转股数量;V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

## （十）赎回条款

### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



## **（十一）回售条款**

### **1、有条件回售条款**

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因六个月后的第一个交易日起而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

## **（十二）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的

权益，在股利发放的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有 A 股普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十三）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

#### 1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。

#### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### 3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

#### **(十四) 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制**

##### 1、违约事件

在本次债券存续期内，以下事件构成发行人在债券受托管理协议和本次债券项下的违约事件：

(1) 公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；

(2) 除债券受托管理协议另有约定外，公司不履行或违反债券受托管理协议关于公司义务的规定，出售重大资产以致对公司本次债券或本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

(3) 公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；

(4) 公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；

(5) 公司未按照债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次债券或本期债券募集资金用途；

(6) 其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

##### 2、违约责任

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

### 3、争议解决机制

受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，双方约定通过向受托管理人住所所在地有管辖权人民法院提起诉讼方式解决争议。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下的其他义务。

## 五、本次发行的有关机构

### （一）发行人

名称	合肥新汇成微电子股份有限公司
法定代表人	郑瑞俊
住所	合肥市新站区合肥综合保税区内
董事会秘书	奚颢
联系电话	0551-67139968-7099
传真号码	0551-67139968-7099

### （二）保荐人（主承销商）

名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	周杰
住所	上海市广东路 689 号
联系电话	021-23219000
传真号码	021-63411627
保荐代表人	赵庆辰、何立
项目协办人	秦寅臻
其他项目组成员	陈杰、邢丞栋、李翔

### （三）律师事务所

名称	安徽天禾律师事务所
机构负责人	卢贤榕
住所	合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层
联系电话	0551-62642792

传真号码	0551-62620450
经办律师	卢贤榕、陈磊、孙静

**(四) 会计师事务所**

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	王国海
住所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
联系电话	0571-88216888
传真号码	0571-88216999
经办注册会计师	向晓三、许红瑾

**(五) 申请上市的证券交易所**

名称	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区杨高南路 388 号
电话	021-68808888
传真	021-68804868

**(六) 资信评级机构**

机构名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人	张剑文
住所	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系电话	0755-82872897
传真号码	0755-82872090
经办评级人员	董斌、李爱文

**(七) 收款银行**

开户行	上海银行徐汇支行
户名	海通证券股份有限公司
账号	03004485897

**(八) 证券登记机构**

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址	上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话	021-58708888

传真	021-58899400
----	--------------

## 六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司持有汇成股份 6,678,826 股，持股比例 0.80%；海通新动能持有汇成股份 12,727,273 股，持股比例 1.52%，保荐机构子公司海通开元持有海通新能源 51.00%股权，海通新能源系海通新动能执行事务合伙人并持股 0.67%，海通开元另持有海通新动能 19.33%股权；保荐机构子公司上海海通证券资产管理有限公司资管业务持有汇成股份 6,868 股，持股比例 0.00082%；保荐机构衍生产品与交易部多空互换对冲账户持有汇成股份 43,002 股，持股比例 0.0052%。除此之外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

### 第三节 发行人基本情况

#### 一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况

##### (一) 股本结构

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 83,485.3281 万股，具体情况如下：

序号	股东性质	持股数量（万股）	占公司总股本比例
1	有限售条件股份	37,847.87	45.33%
2	其中：国有法人持股	222.50	0.27%
3	境内非国有法人持股	29,577.64	35.43%
4	境内自然人持股	3,026.06	3.62%
5	境外法人持股	5,021.67	6.02%
6	境外自然人持股	-	-
7	无限售条件流通股份	45,637.46	54.67%
合计		<b>83,485.33</b>	<b>100.00%</b>

##### (二) 前十名股东的持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（万股）
1	扬州新瑞连	境内非国有法人	17,410.36	20.85	17,410.36
2	嘉兴高和	境内非国有法人	6,000.00	7.19	-
3	汇成投资	境外法人	3,771.67	4.52	3,771.67
4	志道投资	境内非国有法人	2,430.00	2.91	-
5	杨会	境内自然人	2,359.39	2.83	2,359.39
6	Advance	境外法人	2,000.00	2.40	-
7	四川鼎祥股权投资基金有限公司	境内非国有法人	1,818.18	2.18	1,818.18
8	蔚华电子	境内非国有法人	1,600.00	1.92	-
9	安徽正奇资产管理有限公司	境内非国有法人	1,570.00	1.88	-
10	Great Title	境外法人	1,515.39	1.82	-
合计			<b>40,474.99</b>	<b>48.48</b>	<b>25,359.60</b>

## 二、公司控股股东、实际控制人基本情况

### （一）控股股东

截至 2023 年 12 月 31 日，扬州新瑞连持有发行人 20.85% 的股份，系发行人控股股东，扬州新瑞连具体情况如下：

企业名称	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2014 年 5 月 13 日
认缴出资额	50 万元
实缴出资额	50 万元
注册地址	扬州高新技术产业开发区纵一路与横三路交界处管委会大楼内 12 楼 1202 室
执行事务合伙人	杨会
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询服务。
主营业务	投资管理
与发行人主营业务关系	无

截至 2023 年 12 月 31 日，扬州新瑞连的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨会	普通合伙人	35.00	70.00
2	纪念	有限合伙人	15.00	30.00
合计			<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

最近一年，扬州新瑞连的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023.12.31/2023 年度
总资产	39,687.88
净资产	51.54
营业收入	-
净利润	0.02

注：上表中财务数据未经审计。

### （二）实际控制人

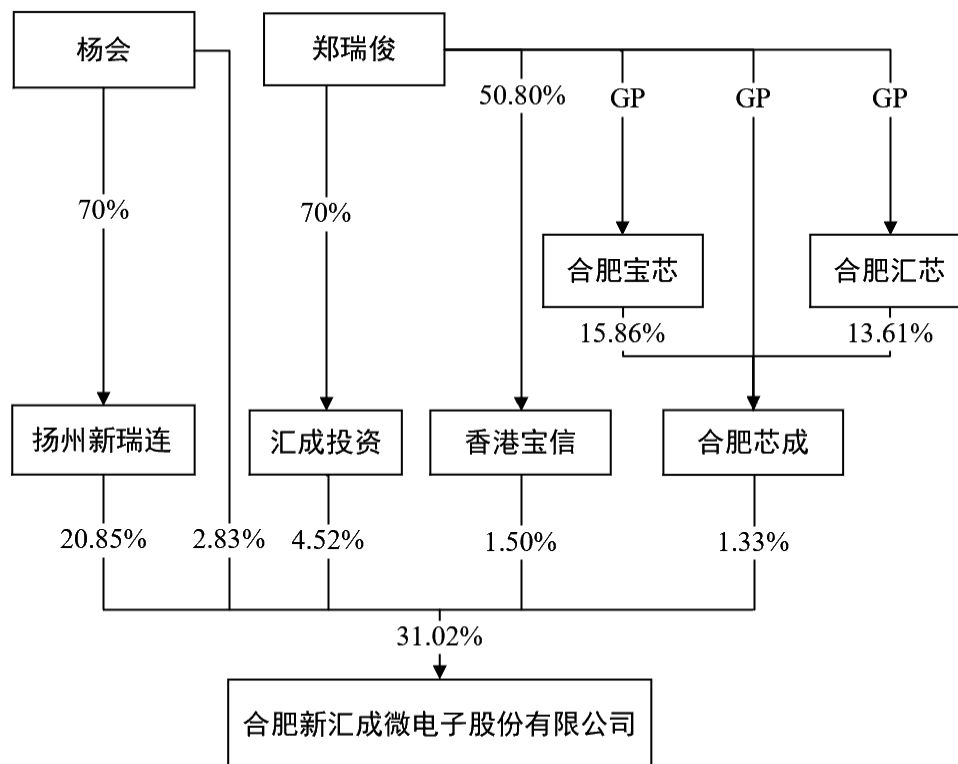
郑瑞俊、杨会系夫妻关系。



截至 2023 年 12 月 31 日，郑瑞俊持有汇成投资 70% 的股份，为汇成投资的实际控制人，并通过汇成投资间接控制发行人 4.52% 的股份；郑瑞俊持有香港宝信 50.80% 的股权，为香港宝信第一大股东，且香港宝信其他股东持股较为分散，故郑瑞俊为香港宝信的实际控制人，通过香港宝信间接控制发行人 1.50% 的股份；郑瑞俊担任合肥芯成的执行事务合伙人，为合肥芯成的实际控制人，通过合肥芯成间接控制发行人 1.33% 的股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，杨会直接持有发行人 2.83% 的股份；同时，杨会担任扬州新瑞连的执行事务合伙人，为扬州新瑞连的实际控制人，通过扬州新瑞连间接控制发行人 20.85% 的股份。

郑瑞俊、杨会直接持有及间接控制发行人股份的情况具体如下图所示：



综上，郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 31.02% 的股份表决权，同时郑瑞俊担任发行人董事长、总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响，郑瑞俊、杨会为公司共同实际控制人。

公司实际控制人的基本信息如下：

郑瑞俊先生，中国台湾人士，台湾居民来往大陆通行证号 0070\*\*\*\*。

杨会女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 341127198205\*\*\*\*\*。

### (三) 上市以来控股股东、实际控制人变化情况

公司自上市以来,控股股东、实际控制人均未发生变化。

### (四) 控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或潜在纠纷的情况。

### (五) 实际控制人对其他企业的投资情况

截至本募集说明书签署日,除公司及子公司、控股股东扬州新瑞连外,公司实际控制人郑瑞俊、杨会主要对外投资情况如下:

姓名	对外投资企业名称	出资比例/ 持股比例 (%)
郑瑞俊	合肥芯成	37.91
	合肥宝芯	23.98
	合肥汇芯	22.52
	香港宝信	50.80
	汇成投资	70.00
	瑞成建筑	80.00
	瑞成投资	70.00
	百瑞发投资	50.96
	天虹科技	6.37
杨会	南京邦盛聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)	37.04
	苏州邦盛聚泽创业投资企业(有限合伙)	9.98
	苏州盛泽邦盛成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)	3.77

## 第四节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务会计数据均引自经审计的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行更详细的了解，还应阅读审计报告和财务报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

#### （一）审计意见类型

公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度的财务报表进行审计，并出具了“天健审〔2022〕278 号”、“天健审〔2023〕2878 号”和“天健审〔2024〕2278 号”无保留意见的审计报告。

天健会计师认为：发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的经营成果和现金流量。

#### （二）重要性水平

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为当年营业收入金额的 0.5%，或者虽未达到当年营业收入金额的 0.5%，但公司认为较为重要的相关事项。

### 二、发行人财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
货币资金	11,014.13	12,978.32	4,636.23
交易性金融资产	2,019.23	60,144.17	-
应收账款	23,124.61	10,891.96	17,517.42
预付款项	114.33	582.18	288.63

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
其他应收款	39.47	136.79	19.49
存货	23,699.77	20,568.76	17,063.90
一年内到期的非流动资产	1,044.94	-	-
其他流动资产	4,198.15	12,279.52	7,015.43
<b>流动资产合计</b>	<b>65,254.63</b>	<b>117,581.70</b>	<b>46,541.09</b>
其他非流动金融资产	5,000.00	-	-
固定资产	239,511.30	174,795.26	146,287.78
在建工程	18,068.39	7,797.22	3,259.23
使用权资产	398.31	409.53	-
无形资产	2,574.61	1,773.22	1,711.90
递延所得税资产	373.01	1,788.41	-
其他非流动资产	28,449.43	15,417.91	5,992.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>294,375.06</b>	<b>201,981.55</b>	<b>157,250.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>359,629.70</b>	<b>319,563.25</b>	<b>203,792.02</b>
短期借款	18,559.36	-	36,760.64
应付票据	399.60	-	-
应付账款	14,132.99	8,362.18	8,406.27
合同负债	290.64	5,037.65	47.11
应付职工薪酬	2,606.78	1,697.63	1,145.71
应交税费	163.02	156.59	76.59
其他应付款	64.74	24.32	36.53
一年内到期的非流动负债	236.17	188.75	2,503.22
其他流动负债	35.29	646.54	-
<b>流动负债合计</b>	<b>36,488.59</b>	<b>16,113.67</b>	<b>48,976.08</b>
长期借款	-	-	5,387.14
租赁负债	126.85	217.71	-
递延收益	9,811.19	11,405.66	10,068.68
递延所得税负债	-	1,455.62	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,938.04</b>	<b>13,078.99</b>	<b>15,455.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>46,426.63</b>	<b>29,192.66</b>	<b>64,431.90</b>
股本	83,485.33	83,485.33	66,788.26
资本公积	213,563.65	210,282.67	93,738.76
其他综合收益	-	47.00	-

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
盈余公积	5,125.59	3,020.85	1,233.81
未分配利润	11,028.50	-6,465.26	-22,400.72
归属于母公司股东权益合计	313,203.07	290,370.59	139,360.11
<b>股东权益合计</b>	<b>313,203.07</b>	<b>290,370.59</b>	<b>139,360.11</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>359,629.70</b>	<b>319,563.25</b>	<b>203,792.02</b>

## (二) 合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>123,829.30</b>	<b>93,965.28</b>	<b>79,569.99</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>106,315.45</b>	<b>79,888.49</b>	<b>67,173.00</b>
其中：营业成本	91,077.63	66,978.21	56,001.84
税金及附加	444.67	436.08	228.55
销售费用	840.96	904.06	549.42
管理费用	6,666.60	5,216.50	4,055.28
研发费用	7,885.72	6,514.01	6,060.30
财务费用	-600.12	-160.36	277.62
其中：利息费用	-0.48	873.63	27.17
利息收入	210.23	223.42	83.97
加：其他收益	2,202.13	2,065.51	1,909.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,021.27	266.47	-5.74
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	155.50	-	-5.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	424.28	144.17	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-639.70	338.79	-111.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,015.75	-1,440.82	-907.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	335.06	1,473.23	330.96
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,841.15</b>	<b>16,924.14</b>	<b>13,612.63</b>
加：营业外收入	84.63	536.04	423.16
减：营业外支出	367.49	70.48	3.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>19,558.29</b>	<b>17,389.70</b>	<b>14,031.82</b>

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
减：所得税费用	-40.21	-332.80	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,598.50</b>	<b>17,722.50</b>	<b>14,031.82</b>
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,598.50	17,722.50	14,031.82
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,598.50	17,722.50	14,031.82
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47.00	47.00	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>19,551.51</b>	<b>17,769.49</b>	<b>14,031.82</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,551.51	17,769.49	14,031.82
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	0.23	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.24	0.21

### （三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	111,966.09	111,654.87	78,935.26
收到的税费返还	6,108.08	11,689.65	1,769.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,200.74	4,625.64	4,105.80
经营活动现金流入小计	119,274.91	127,970.16	84,810.83
购买商品、接受劳务支付的现金	64,268.61	50,764.99	41,362.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,437.69	13,535.38	11,567.06
支付的各项税费	460.19	498.92	269.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,962.45	3,056.70	2,071.18
经营活动现金流出小计	84,128.95	67,855.99	55,270.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,145.96</b>	<b>60,114.17</b>	<b>29,539.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
收回投资收到的现金	169,800.00	83,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,221.39	200.52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589.42	2,316.31	1,041.36
投资活动现金流入小计	171,610.81	85,516.83	1,041.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,819.17	58,261.58	39,632.75
投资支付的现金	107,800.00	165,000.00	-
投资活动现金流出小计	226,619.17	223,261.58	39,632.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,008.35</b>	<b>-137,744.76</b>	<b>-38,591.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	135,142.95	9,995.28
取得借款收到的现金	18,542.33	38,349.92	52,998.77
收到其他与筹资活动有关的现金	-	250.00	3,085.00
筹资活动现金流入小计	18,542.33	173,742.87	66,079.05
偿还债务支付的现金	-	82,763.98	46,920.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73.10	1,534.70	1,756.66
支付其他与筹资活动有关的现金	569.63	3,850.68	8,404.15
筹资活动现金流出小计	642.73	88,149.35	57,080.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,899.60</b>	<b>85,593.52</b>	<b>8,998.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>49.23</b>	<b>329.00</b>	<b>-262.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,913.56</b>	<b>8,291.93</b>	<b>-315.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	12,877.43	4,585.50	4,901.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,963.87</b>	<b>12,877.43</b>	<b>4,585.50</b>

### 三、财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》以及各项具体会计准则及相关规定编制财务报表。

## 四、合并财务报表范围及变化情况

### （一）子公司情况

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例
江苏汇成光电有限公司	从事显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务	56,164.02	100.00%

### （二）报告期内合并财务报表范围变化情况

报告期内，发行人合并财务报表范围未发生变化。

## 五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表

### （一）主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下表：

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	1.79	7.30	0.95
速动比率（倍）	1.14	6.02	0.60
资产负债率（合并）	12.91%	9.14%	31.62%
资产负债率（母公司）	9.72%	7.48%	26.17%
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	6.92	6.28	4.58
存货周转率（次）	3.95	3.40	3.66
息税折旧摊销前利润（万元）	47,730.24	39,909.84	31,195.48
利息保障倍数（倍）	/	20.91	517.42
每股经营活动现金流量（元）	0.42	0.72	0.44
每股净现金流量（元）	-0.02	0.10	-

注 1：上述财务指标计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- （3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均余额
- （6）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- （7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- （8）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

注 2：2023 年度公司利息费用为负，因此未计算利息保障倍数，下同。



## （二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

### 1、加权平均净资产收益率

报告期内，公司加权平均净资产收益率如下表所示：

利润项目	加权平均净资产收益率		
	2023年度	2022年度	2021年度
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	6.49	9.19	10.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	5.57	6.54	7.17

### 2、基本每股收益及稀释每股收益

报告期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：

利润项目	基本每股收益（元/股）			稀释每股收益（元/股）		
	2023年度	2022年度	2021年度	2023年度	2022年度	2021年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.24	0.21	0.23	0.24	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.17	0.14	0.20	0.17	0.14

注：上述指标的计算公式如下：

$$1、\text{加权平均净资产收益率} = P_0 \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$2、\text{基本每股收益} = P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益 =  $P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中,  $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

### (三) 公司最近三年一期的非经常性损益明细表

#### 1、注册会计师鉴证的非经常性损益情况

报告期内, 公司经天健会计师鉴证后的非经常性损益情况如下:

单位: 万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	261.96	1,404.61	330.96
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,569.16	2,979.05	4,296.13
委托他人投资或管理资产的损益	155.50	77.30	-
债务重组损益	-	-	-5.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,290.05	333.33	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-250.88	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246.77	70.18	20.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	239.85	-2.92
<b>小计</b>	<b>2,779.03</b>	<b>5,104.33</b>	<b>4,638.63</b>
减: 所得税影响数	-	-	-
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>	<b>2,779.03</b>	<b>5,104.33</b>	<b>4,638.63</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>16,819.47</b>	<b>12,618.17</b>	<b>9,393.19</b>

#### 2、非经常性损益对经营成果的影响

报告期各期, 公司非经常性损益分别为 4,638.63 万元、5,104.33 万元和 2,779.03 万元。公司非经常性损益主要为股份支付、政府补助、非流动资产处置损益和投资收益等。

公司作为从事显示驱动芯片的先进封测业务的领先企业, 持续得到政府部门的重点支持。报告期内, 计入当期损益的政府补助较多, 因此非经常性损益金额

较大。

随着公司生产规模逐年扩大，公司自 2021 年起持续盈利，公司经营活动产生的现金流量情况良好，非经常性损益对经营成果的影响逐渐降低。

## 六、报告期内会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

### （一）会计政策变更

#### 1、新租赁准则

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

3、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

5、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

6、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16

号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

7、公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

## （二）会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更事项。

## （三）会计差错更正

公司报告期内无会计差错更正事项。

## 七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策

### （一）主要的税种和税率

报告期内，公司适用的主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

报告期内，不同纳税主体企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	企业所得税税率		
	2023 年度	2022 年度	2021 年度
汇成股份	15%	15%	15%
江苏汇成	15%	15%	15%

### （二）重要税收优惠政策及其依据

#### 1、汇成股份税收优惠

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局公示《关于公布安徽省2019年第二批高新技术企业认定名单的通知》，汇成股份在2019年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201934001917），按税法规定2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局公示《关于公布安徽省2022年第一批高新技术企业认定名单的通知》。汇成股份在2022年第一批中被认定为高新技术企业（证书编号：GR202234004596），按税法规定2022-2024年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告2020年第45号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。

## 2、江苏汇成企业税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示《关于对江苏省2021年认定的第四批高新技术企业进行备案公示的通知》。江苏汇成在2021年第四批中被认定为高新技术企业（证书编号：GR202132011450），按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。

## 八、财务状况分析

### （一）资产结构及变动分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	65,254.63	18.14%	117,581.70	36.79%	46,541.09	22.84%
非流动资产	294,375.06	81.86%	201,981.55	63.21%	157,250.92	77.16%
合计	<b>359,629.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>319,563.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,792.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司总资产分别为 203,792.02 万元、319,563.25 万元和 359,629.70 万元，公司的资产规模随着生产规模的扩大而增加。

报告期各期末，公司流动资产分别为 46,541.09 万元、117,581.70 万元和 65,254.63 万元，占总资产的比例分别为 22.84%、36.79%和 18.14%。2022 年末，公司流动资产规模较 2021 年度大幅度增长，主要系公司于 2022 年下半年完成首次公开发行股票并上市，募集资金的到位使得公司流动资产增加；2023 年末，公司流动资产规模 2022 年度有所降低，主要系公司持续购买机器设备，赎回了较多理财产品所致。

报告期各期末，公司的非流动资产分别为 157,250.92 万元、201,981.55 万元和 294,375.06 万元，占总资产的比例分别为 77.16%、63.21%和 81.86%。2022 年，随着公司募集资金到位，购买机器设备的支出持续增加，使得 2022 年末和 2023 年末的非流动资产金额较以前年度大幅增加。

#### 1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	11,014.13	16.88%	12,978.32	11.04%	4,636.23	9.96%
交易性金融资产	2,019.23	3.09%	60,144.17	51.15%	-	-

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收账款	23,124.61	35.44%	10,891.96	9.26%	17,517.42	37.64%
预付款项	114.33	0.18%	582.18	0.50%	288.63	0.62%
其他应收款	39.47	0.06%	136.79	0.12%	19.49	0.04%
存货	23,699.77	36.32%	20,568.76	17.49%	17,063.90	36.66%
一年内到期的非流动资产	1,044.94	1.60%	-	-	-	-
其他流动资产	4,198.15	6.43%	12,279.52	10.44%	7,015.43	15.07%
<b>合计</b>	<b>65,254.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>117,581.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,541.09</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动资产分别为 46,541.09 万元、117,581.70 万元和 65,254.63 万元，主要构成为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货和其他流动资产等。报告期内，公司流动资产规模整体呈先上升后下降的趋势，2022 年末公司流动资产较 2021 年末有所增长主要系随着公司资本实力的增强和经营规模的扩大，货币资金、交易性金融资产、存货等资产相应有所增加；2023 年末公司流动资产较 2022 年末有所减少主要系公司持续购买机器设备，赎回了较多理财产品。

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
库存现金	7.05	0.06	1.70	0.01	3.28	0.07
银行存款	10,956.83	99.48	12,875.73	99.21	4,582.22	98.84
其他货币资金	50.26	0.46	100.88	0.78	50.73	1.09
<b>合计</b>	<b>11,014.13</b>	<b>100.00</b>	<b>12,978.32</b>	<b>100.00</b>	<b>4,636.23</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 4,636.23 万元、12,978.32 万元和 11,014.13 万元，占各期末流动资产比例分别为 9.96%、11.04%和 16.88%。2022 年，公司首次公开发行股票并上市募集资金到账且经营规模持续增长，客户付款情况良好，导致 2022 年末和 2023 年末货币资金规模较 2021 年末有所增加。

## (2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,019.23	60,144.17	-
其中：债务工具投资	-	36,049.90	-
权益工具投资	2,019.23	24,094.26	-
<b>合计</b>	<b>2,019.23</b>	<b>60,144.17</b>	<b>-</b>

2022年末和2023年末，公司交易性金融资产金额分别为60,144.17万元和2,019.23万元。2022年，公司完成首次公开发行股票并上市，由于募集资金到账且公司经营活动现金持续流入，使得公司资金规模大幅增加。为提高募集资金及自有资金的使用效率，公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理。截至2023年12月31日，公司持有的交易性金融资产均为保本型理财产品。

## (3) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应收账款余额	24,341.70	11,465.22	18,439.39
坏账准备	1,217.08	573.26	921.97
<b>应收账款账面价值</b>	<b>23,124.61</b>	<b>10,891.96</b>	<b>17,517.42</b>
<b>应收账款账面余额占营业收入比例</b>	<b>19.66%</b>	<b>12.20%</b>	<b>23.17%</b>

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17,517.42万元、10,891.96万元和23,124.61万元。2022年末，公司应收账款余额有所减少，主要系2022年度公司预收部分主要客户货款金额较大，导致应收账款期末余额较少；2023年末，公司应收账款余额增长，主要系2023年二季度起显示面板市场需求有所回暖，公司2023年下半年销售情况良好导致应收账款期末余额增长。

### 1) 应收账款坏账准备计提情况

报告期内，公司根据新金融工具准则的规定确认应收账款坏账准备，应收账



款余额分类情况如下：

单位：万元

类别	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	24,341.70	100.00	1,217.08	5.00	23,124.61
其中：账龄组合	24,341.70	100.00	1,217.08	5.00	23,124.61
<b>合计</b>	<b>24,341.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,217.08</b>	<b>5.00</b>	<b>23,124.61</b>
类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,465.22	100.00	573.26	5.00	10,891.96
其中：账龄组合	11,465.22	100.00	573.26	5.00	10,891.96
<b>合计</b>	<b>11,465.22</b>	<b>100.00</b>	<b>573.26</b>	<b>5.00</b>	<b>10,891.96</b>
类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	18,439.39	100.00	921.97	5.00	17,517.42
其中：账龄组合	18,439.39	100.00	921.97	5.00	17,517.42
<b>合计</b>	<b>18,439.39</b>	<b>100.00</b>	<b>921.97</b>	<b>5.00</b>	<b>17,517.42</b>

## 2) 应收账款按账龄划分

报告期各期末，公司应收账款按账龄组合计提坏账准备的明细如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
<b>2023.12.31</b>				
1年以内	24,341.70	100.00	1,217.08	5.00
<b>合计</b>	<b>24,341.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,217.08</b>	<b>5.00</b>
<b>2022.12.31</b>				
1年以内	11,465.22	100.00	573.26	5.00

合计	11,465.22	100.00	573.26	5.00
<b>2021.12.31</b>				
1年以内	18,439.39	100.00	921.97	5.00
合计	18,439.39	100.00	921.97	5.00

报告期各期末，公司应收账款均为1年以内。公司制定的应收账款坏账计提政策符合公司实际情况，不存在因应收账款金额过大而影响公司持续经营能力的情形。

#### (4) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

账龄	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	114.33	100.00	582.18	100.00	288.63	100.00
合计	114.33	100.00	582.18	100.00	288.63	100.00

报告期各期末，公司预付账款金额分别为288.63万元、582.18万元和114.33万元，主要为预付的供应商货款、租金等，占流动资产的比例较低。

#### (5) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为19.49万元、136.79万元和39.47万元，主要为应收设备退货款和押金保证金等，金额较小。

#### (6) 存货

报告期各期末，公司存货结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	占比 (%)
<b>2023.12.31</b>				
原材料	15,128.09	212.28	14,915.82	62.94
在产品	791.07	138.35	652.72	2.75
库存商品	7,986.25	438.96	7,547.29	31.85
发出商品	572.66	30.16	542.50	2.29
低值易耗品	41.45	-	41.45	0.17

合计	24,519.52	819.75	23,699.77	100.00
<b>2022.12.31</b>				
原材料	13,049.94	349.30	12,700.63	61.75
在产品	774.89	125.08	649.81	3.16
库存商品	7,526.60	552.68	6,973.92	33.91
发出商品	226.46	18.43	208.03	1.01
低值易耗品	36.37	-	36.37	0.18
合计	21,614.25	1,045.49	20,568.76	100.00
<b>2021.12.31</b>				
原材料	12,400.60	439.08	11,961.51	70.10
在产品	690.33	86.12	604.21	3.54
库存商品	4,462.15	173.74	4,288.41	25.13
发出商品	175.30	6.21	169.10	0.99
低值易耗品	40.67	-	40.67	0.24
合计	17,769.05	705.15	17,063.90	100.00

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 17,063.90 万元、20,568.76 万元和 23,699.77 万元，占流动资产的比例分别为 36.66%、17.49%和 36.32%。随着公司生产经营规模持续增长，报告期各期末公司存货账面价值整体呈上升趋势。

报告期各期末，公司存货主要由原材料及库存商品构成，原材料账面余额分别为 12,400.60 万元、13,049.94 万元和 15,128.09 万元，库存商品账面余额分别为 4,462.15 万元、7,526.60 万元和 7,986.25 万元，总体呈上升趋势，主要系随着业务规模扩大，公司整体原材料备货规模和库存规模相应增加。

公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 705.15 万元、1,045.49 万元和 819.75 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
存货账面余额	24,519.52	21,614.25	17,769.05
存货跌价准备	819.75	1,045.49	705.15
存货账面价值	23,699.77	20,568.76	17,063.90
存货跌价准备计提比例	3.34%	4.84%	3.97%

报告期各期末，公司存货跌价准备存在一定规模，存货跌价准备计提比例总体相对平稳，主要系：1) 公司原材料中含金成分较高，黄金价格的波动会影响公司账面持有含金原料的市场价值，公司各期末根据黄金价格测算跌价影响；2) 2022 年下半年公司产品终端应用市场消费需求有所下滑，销售单价有所降低，存货跌价准备规模略有增长；2023 年第二季度起，显示面板市场需求有所回暖，公司产品产销量增长，2023 年末存货跌价准备规模随之下降。公司存货跌价准备计提充分，符合《企业会计准则》的有关规定。

### (7) 一年内到期的非流动资产

2023 年末，公司一年内到期的非流动资产为 1,044.94 万元，系公司持有的一年内到期的大额存单。

### (8) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
理财产品	-	12,077.30	-
待抵扣进项税额	4,041.85	202.22	6,676.78
预付 IPO/可转债相关中介费用	142.92	-	256.98
待摊费用	13.38	-	81.67
<b>合计</b>	<b>4,198.15</b>	<b>12,279.52</b>	<b>7,015.43</b>

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 7,015.43 万元、12,279.52 万元和 4,198.15 万元。2022 年末，公司其他流动资产中理财产品金额有所增加，主要系公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理购买理财产品所致；其他流动资产中待抵扣进项税额金额大幅减少，主要系公司于 2022 年度收到大额存量留抵税额返还所致；2023 年末，公司其他流动资产中理财产品金额减少主要系部分理财产品到期赎回所致；其他流动资产中待抵扣进项税额金额增加，主要系公司于 2023 年度持续购置机器设备所致。

## 2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他非流动金融资产	5,000.00	1.70%	-	-	-	-
固定资产	239,511.30	81.36%	174,795.26	86.54%	146,287.78	93.03%
在建工程	18,068.39	6.14%	7,797.22	3.86%	3,259.23	2.07%
使用权资产	398.31	0.14%	409.53	0.20%	-	-
无形资产	2,574.61	0.87%	1,773.22	0.88%	1,711.90	1.09%
递延所得税资产	373.01	0.13%	1,788.41	0.89%	-	-
其他非流动资产	28,449.43	9.66%	15,417.91	7.63%	5,992.01	3.81%
<b>非流动资产合计</b>	<b>294,375.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>201,981.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>157,250.92</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产分别为 157,250.92 万元、201,981.55 万元和 294,375.06 万元，主要构成为固定资产、在建工程和其他非流动资产等。报告期内，公司非流动资产规模持续增长，主要系随着业务规模扩大和资本实力增强，公司持续购置专用设备所致。

### (1) 其他非流动金融资产

2023 年末，公司其他非流动金融资产为 5,000.00 万元，系公司参与设立产业基金晶汇聚芯形成的权益性投资。

### (2) 固定资产

#### 1) 固定资产构成情况

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
房屋及建筑物	27,295.13	26,799.22	25,548.72
通用设备	839.83	380.28	426.48
专用设备	211,226.02	147,588.56	120,268.42
运输工具	150.33	27.20	44.17
<b>合计</b>	<b>239,511.30</b>	<b>174,795.26</b>	<b>146,287.78</b>

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 146,287.78 万元、174,795.26 万元和 239,511.30 万元，占非流动资产的比例分别为 93.03%、86.54%和 81.36%，

主要由专用设备和房屋及建筑物构成。其中专用设备增长较快，主要系报告期内公司持续购置先进专用设备扩充产能所致。

## 2) 固定资产折旧及减值情况

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值
<b>2023.12.31</b>				
房屋及建筑物	38,757.76	11,462.63	-	27,295.13
通用设备	2,253.74	1,413.91	-	839.83
专用设备	303,571.07	92,345.05	-	211,226.02
运输工具	306.59	156.25	-	150.33
<b>合计</b>	<b>344,889.16</b>	<b>105,377.85</b>	<b>-</b>	<b>239,511.30</b>
<b>2022.12.31</b>				
房屋及建筑物	36,849.94	10,050.72	-	26,799.22
通用设备	1,617.26	1,236.98	-	380.28
专用设备	215,254.40	67,665.84	-	147,588.56
运输工具	166.67	139.47	-	27.20
<b>合计</b>	<b>253,888.26</b>	<b>79,093.01</b>	<b>-</b>	<b>174,795.26</b>
<b>2021.12.31</b>				
房屋及建筑物	34,297.90	8,749.18	-	25,548.72
通用设备	1,494.35	1,067.87	-	426.48
专用设备	169,861.44	49,593.03	-	120,268.42
运输工具	182.23	138.07	-	44.17
<b>合计</b>	<b>205,835.92</b>	<b>59,548.15</b>	<b>-</b>	<b>146,287.78</b>

公司于资产负债表日对各项固定资产进行减值测试，经测试未发现减值迹象，未计提减值准备。

### (3) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 3,259.23 万元、7,797.22 万元和 18,068.39 万元，占非流动资产的比例分别为 2.07%、3.86%和 6.14%，均为在安装设备。报告期内，公司持续扩产并购置专用设备，部分专用设备于报告期末尚处于安装调试阶段。公司在建工程无减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

### (4) 使用权资产

公司于 2021 年起适用新租赁准则，将租赁的房屋及建筑物确认为使用权资产。2022 年末和 2023 年末，发行人使用权资产账面价值分别为 409.53 万元和 398.31 万元，占非流动资产的比例较低。

### (5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
土地使用权	1,434.54	1,469.22	1,503.90
软件	1,140.07	304.00	208.01
合计	<b>2,574.61</b>	<b>1,773.22</b>	<b>1,711.90</b>

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 1,711.90 万元、1,773.22 万元和 2,574.61 万元，占非流动资产的比例分别为 1.09%、0.88%和 0.87%，主要为土地使用权和软件。2023 年末，公司无形资产账面价值较 2022 年末有所增长，主要系 2023 年度公司购置软件金额较大所致。报告期各期末，公司土地使用权不存在减值迹象，故未计提减值准备。

### (6) 递延所得税资产

2022 年末和 2023 年末，公司递延所得税资产主要系可抵扣亏损和递延收益等原因所致，占非流动资产的比例较小。

### (7) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
大额存单	12,449.34	10,047.00	-
预付设备工程款	15,005.33	5,245.17	5,791.87
预付软件款	694.76	125.74	200.14
预付土地出让款	300.00	-	-
合计	<b>28,449.43</b>	<b>15,417.91</b>	<b>5,992.01</b>

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 5,992.01 万元、15,417.91 万元和 28,449.43 万元，占非流动资产的比例分别为 3.81%、7.63%和

9.66%，主要为预付的高端测试机、探针台等专用设备款和购买的大额存单等。2022年末和2023年末，公司其他非流动资产中大额存单金额有所增加，主要系公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理购买大额存单所致；2023年末，公司其他非流动资产中预付设备工程款金额大幅增加，主要系公司为扩充产能而预付供应商设备款金额增加所致。

## （二）负债结构及变动分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	36,488.59	78.59%	16,113.67	55.20%	48,976.08	76.01%
非流动负债	9,938.04	21.41%	13,078.99	44.80%	15,455.82	23.99%
合计	<b>46,426.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,192.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,431.90</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 64,431.90 万元、29,192.66 万元和 46,426.63 万元。2022 年末，公司负债金额大幅减少，主要系 2022 年公司完成首次公开发行股票并上市，使用募集的补流资金归还全部银行借款所致；2023 年末，公司负债金额有所增加，主要系公司持续购置机器设备进行扩产，基于资金需求新增银行借款所致。

### 1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	18,559.36	50.86%	-	-	36,760.64	75.06%
应付票据	399.60	1.10%	-	-	-	-
应付账款	14,132.99	38.73%	8,362.18	51.89%	8,406.27	17.16%
合同负债	290.64	0.80%	5,037.65	31.26%	47.11	0.10%
应付职工薪酬	2,606.78	7.14%	1,697.63	10.54%	1,145.71	2.34%
应交税费	163.02	0.45%	156.59	0.97%	76.59	0.16%



其他应付款	64.74	0.18%	24.32	0.15%	36.53	0.07%
一年内到期的非流动负债	236.17	0.65%	188.75	1.17%	2,503.22	5.11%
其他流动负债	35.29	0.10%	646.54	4.01%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>36,488.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,113.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,976.08</b>	<b>100.00%</b>

公司流动负债主要由短期借款、应付账款、合同负债、应付职工薪酬和一年内到期的非流动负债等组成。

### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
保证借款	-	-	14,096.38
抵押及保证借款	-	-	22,451.40
信用借款	18,542.33	-	-
应付利息	17.03	-	212.86
<b>合计</b>	<b>18,559.36</b>	<b>-</b>	<b>36,760.64</b>

2021年末和2023年末，公司短期借款余额分别为36,760.64万元和18,559.36万元，主要由保证借款、抵押及保证借款和信用借款等构成。2022年，公司使用首次公开发行募集的补流资金归还全部银行借款，2022年末公司无短期借款余额；2023年，公司持续购置机器设备进行扩产，基于资金需求新增信用借款，导致2023年末短期借款余额有所增加。

### (2) 应付票据

2023年末，公司应付票据余额为399.60万元，系公司开具的信用证，占流动负债的比例较小。

### (3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为8,406.27万元、8,362.18万元和14,132.99万元，占各期末流动负债的比例分别为17.16%、51.89%和38.73%。报告期各期末，公司应付账款主要为应付材料货款及设备工程款。2021年起，公

司为满足生产需求持续购置设备扩产，期末应付设备工程款保持较高水平，2023年下半年，公司开始逐步建设本次发行募投项目，导致2023年末应付设备工程款金额进一步增加。

#### **(4) 合同负债**

根据新收入准则，自2020年1月1日起，公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。报告期各期末，公司合同负债期末余额分别为47.11万元、5,037.65万元和290.64万元，占流动负债的比例分别为0.10%、31.26%和0.80%。2022年末，公司合同负债金额有所增长，主要系2022年度上半年行业景气度较好，公司部分主要客户为预先锁定公司产能，向公司预付了部分货款所致。

#### **(5) 应付职工薪酬**

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为1,145.71万元、1,697.63万元和2,606.78万元，占各期末流动负债的比例分别为2.34%、10.54%和7.14%。公司应付职工薪酬主要为应付职工的工资、奖金、津贴、补贴及福利费等，总体呈上涨趋势，系公司人员数量随公司业务发展而增加；2022年末和2023年末公司应付职工薪酬余额较大，主要系截至期末已计提未发放的年终奖金金额较大所致。

#### **(6) 应交税费**

报告期各期末，公司应交税费分别为76.59万元、156.59万元和163.02万元，占各期末流动负债的比例较低，主要由应交房产税、代扣代缴个人所得税、增值税和印花税等构成。

#### **(7) 其他应付款**

报告期各期末，公司其他应付款分别为36.53万元、24.32万元和64.74万元，金额较小，主要为押金保证金等。

#### **(8) 一年内到期的非流动负债**

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为2,503.22万元、188.75万元和236.17万元，占流动负债的比例分别为5.11%、1.17%和0.65%，主要为一年内到期的长期借款、长期应付款和租赁负债。2021年起，公司持续

进行股权融资并优化负债结构，2022 年公司完成首次公开发行，使用募集的补流资金归还全部银行借款，一年内到期的非流动负债金额大幅下降。

### （9）其他流动负债

2022 年末和 2023 年末，公司其他流动负债金额分别为 646.54 万元和 35.29 万元，占流动负债的比例较低，均系待转销项税额。

## 2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	-	-	-	-	5,387.14	34.86%
租赁负债	126.85	1.28%	217.71	1.66%	-	-
递延收益	9,811.19	98.72%	11,405.66	87.21%	10,068.68	65.14%
递延所得税负债	-	-	1,455.62	11.13%	-	-
<b>合计</b>	<b>9,938.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,078.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,455.82</b>	<b>100.00%</b>

公司非流动负债主要由长期借款、递延收益和递延所得税负债等组成。

### （1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
保证借款	-	-	4,150.00
抵押、质押及保证借款	-	-	1,231.68
应付利息	-	-	5.46
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,387.14</b>

2021 年末，公司长期借款余额为 5,387.14 万元，占非流动负债的比例为 34.86%。2022 年度，公司使用首次公开发行募集的补流资金偿还了全部银行贷款，导致 2022 年末和 2023 年末公司无长期借款余额。

### （2）租赁负债

2021年起，公司执行新租赁准则，2022年末和2023年末公司租赁负债分别为217.71万元和126.85万元。

### （3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益金额分别为10,068.68万元、11,405.66万元和9,811.19万元，占非流动负债的比例分别为65.14%、87.21%和98.72%，均为与资产相关的政府补助。

### （4）递延所得税负债

2022年末，公司递延所得税负债主要系固定资产折旧税法与会计准则差异所致。

## （三）偿债能力分析

报告期内，公司与偿债有关的财务指标如下表：

财务指标	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	1.79	7.30	0.95
速动比率（倍）	1.14	6.02	0.60
资产负债率（合并）	12.91%	9.14%	31.62%
财务指标	2023年度	2022年度	2021年度
息税折旧摊销前利润（万元）	47,730.24	39,909.84	31,195.48
利息保障倍数（倍）	/	20.91	517.42
经营活动产生的现金流量净额（万元）	35,145.96	60,114.17	29,539.89

### 1、偿债能力指标分析

2022年末，公司流动比率和速动比率较2021年度大幅增长，资产负债率大幅下降，主要系：一方面，发行人完成首次公开发行，使用首次公开发行募集的补流资金归还全部银行借款，流动负债规模下降；另一方面，公司收入持续增长，下游客户回款良好，流动资产有所增长；2023年末，公司流动比率和速动比率较2022年度有所降低，资产负债率有所上升，主要系2023年公司持续购置机器设备进行扩产，货币资金及交易性金融资产余额有所减少，导致流动资产规模下降，且公司基于资金需求新增短期银行借款，导致流动负债有所增加。

报告期内，公司盈利能力较强，息税折旧摊销前利润分别为 31,195.48 万元、39,909.84 万元和 47,730.24 万元，整体呈上升趋势。

2021 年度和 2022 年度，公司利息保障倍数分别为 517.42 倍和 20.91 倍。2021 年起，随着公司资本结构不断优化，盈利能力稳步提升，公司利润可以较好地覆盖公司的利息支出，付息能力较强；2023 年，由于公司收到财政贴息 110.22 万元冲减财务费用导致利息支出为负，因此未计算利息保障倍数。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 29,539.89 万元、60,114.17 万元和 35,145.96 万元。报告期内，公司经营规模持续扩大，公司经营活动产生的现金流量情况良好；2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较大，主要系公司收到退回的留抵进项税额以及客户为锁定产能预付的货款金额较大所致。

综上所述，公司盈利能力较强，具有较好的偿债能力。

## 2、偿债能力同行业比较分析

报告期内，公司偿债能力与同行业对比如下：

指标	公司	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	颀中科技	3.06	1.76	1.87
	通富微电	0.94	0.96	0.89
	利扬芯片	0.87	1.51	2.42
	晶方科技	5.69	5.90	7.36
	气派科技	0.43	0.62	0.91
	颀邦科技	2.45	1.99	1.74
	南茂科技	3.42	2.90	2.30
	平均值	2.41	2.23	2.50
	<b>发行人</b>	<b>1.79</b>	<b>7.30</b>	<b>0.95</b>
速动比率（倍）	颀中科技	2.65	1.26	1.33
	通富微电	0.70	0.70	0.69
	利扬芯片	0.82	1.42	2.26
	晶方科技	5.46	5.64	6.92
	气派科技	0.29	0.44	0.74
	颀邦科技	2.08	1.70	1.54

	南茂科技	3.06	2.37	1.83
	平均值	2.15	1.93	2.19
	<b>发行人</b>	<b>1.14</b>	<b>6.02</b>	<b>0.60</b>
资产负债率 (合并口径, %)	颀中科技	18.50	33.17	34.10
	通富微电	57.87	59.13	59.33
	利扬芯片	45.26	35.84	16.61
	晶方科技	14.56	12.36	11.58
	气派科技	60.03	50.24	45.72
	颀邦科技	11.09	19.75	22.54
	南茂科技	46.16	44.79	42.65
	平均值	36.21	36.47	33.22
	<b>发行人</b>	<b>12.91</b>	<b>9.14</b>	<b>31.62</b>

注：同行业可比公司数据均取自于公开披露数据。

2021年，公司通过短期借款等方式筹措资金用于购置专用设备进行扩产，导致流动比率和速动比率低于同行业平均水平；2022年，公司完成首次公开发行，使用募集的补流资金归还了全部银行借款，使得公司2022年末的偿债能力优于同行业可比公司平均水平。2023年，公司流动比率和速动比率有所下降，低于同行业可比公司平均水平，主要系2023年公司持续购置机器设备进行扩产，货币资金及交易性金融资产余额有所减少，导致流动资产规模下降，且公司基于资金需求新增短期银行借款，导致流动负债有所增加。

#### （四）营运能力分析

报告期内公司主要营运能力指标如下：

项目	2023年度	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次）	6.92	6.28	4.58
存货周转率（次）	3.95	3.40	3.66

##### 1、营运能力指标分析

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率总体情况良好，存货周转率指标较为稳定。2022年度和2023年度公司应收账款周转率有所提升，主要系2022年度公司部分主要客户为锁定公司产能预付部分货款，导致应收账款期末余额相对减少所致。

## 2、营运能力同行业比较分析

报告期内，公司营运能力与同行业对比如下：

指标	公司	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率 (次)	颀中科技	13.43	10.60	9.10
	通富微电	5.13	6.10	7.60
	利扬芯片	3.17	3.65	4.65
	晶方科技	9.75	11.64	12.25
	气派科技	4.83	4.72	6.99
	颀邦科技	4.65	4.42	4.95
	南茂科技	4.40	4.38	4.68
	平均值	6.48	6.50	7.17
	<b>发行人</b>	<b>6.92</b>	<b>6.28</b>	<b>4.58</b>
存货周转率 (次)	颀中科技	2.65	2.31	2.92
	通富微电	5.75	6.36	6.99
	利扬芯片	15.29	12.41	14.31
	晶方科技	3.49	3.81	5.25
	气派科技	5.06	4.37	5.78
	颀邦科技	8.59	9.72	12.75
	南茂科技	5.87	5.60	7.31
	平均值	6.67	6.37	7.90
	<b>发行人</b>	<b>3.95</b>	<b>3.40</b>	<b>3.66</b>

注：同行业可比公司数据均取自于公开披露数据。

2021 年度，公司应收账款周转率低于同行业平均水平，但与境外同行业可比公司接近；2022 年和 2023 年，公司部分主要客户为锁定公司产能预付了部分货款，公司 2022 年末应收账款余额有所下降，公司应收账款周转率有所提升，接近同行业可比公司平均水平。

报告期内，公司存货周转率处于同行业可比公司区间内，低于同行业可比公司平均水平，主要系：一方面，利扬芯片仅从事测试业务，主营业务成本主要由机器设备折旧、直接人工和制造费用组成，原材料使用量较少，存货周转率远高于同行业可比公司；另一方面，中国台湾同行业可比公司颀邦科技和南茂科技以完工进度确认收入，确认收入的同时相应结转成本，期末存货主要为原物料，收

入确认方式不同导致其存货余额相对较少，存货周转率较高。

## （五）财务性投资分析

### 1、公司最近一期末的财务性投资情况

截至2023年末和2024年3月末，发行人持有的财务性投资金额均为5,000.00万元，拟持有的财务性投资金额为130.00万元，系公司参与设立产业基金形成的权益性投资，具体情况参见本节之“八、财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“3、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资”。

截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计均为5,130.00万元，占2023年12月31日和2024年3月31日公司合并报表归属于母公司净资产的比例分别为1.64%和1.66%，占比较小，不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十的情形，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

### 2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资

#### （1）2023年末

截至2023年末，公司持有的金融产品具体情况如下：

单位：万元

序号	机构名称	产品名称	类型	起息日/受让日	到期日	本金余额
1	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利10期浮动收益凭证	本金保障型	2023/6/19	2024/1/4	2,000.00
2	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2024/8/25	1,000.00
3	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/6/10	5,000.00
4	杭州银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2023/1/18	2025/6/24	3,000.00
5	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/7/7	3,000.00
6	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2025/7/28	1,000.00
合计						15,000.00

如上表所示，截至2023年末发行人持有的金融产品风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，不属于财务性投资。



**(2) 2024年3月末**

截至2024年3月末，公司持有的金融产品具体情况如下：

单位：万元

序号	机构名称	产品名称	类型	起息日/受让日	到期日	本金余额
1	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利52期浮动收益凭证	本金保障型	2024/3/25	2024/6/25	2,000.00
2	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2024/8/25	1,000.00
3	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/6/10	5,000.00
4	杭州银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2023/1/18	2025/6/24	3,000.00
5	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/7/7	3,000.00
6	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2025/7/28	1,000.00
<b>合计</b>						<b>15,000.00</b>

如上表所示，截至2024年3月末发行人持有的金融产品风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，不属于财务性投资。

### 3、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资

发行人本次发行的董事会决议日为2023年6月16日，决议日前六个月至本募集说明书摘要签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资为5,130.00万元，具体情况如下：

2023年11月1日，发行人召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，发行人作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯出资人民币5,000万元，并作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯普通合伙人晶合汇信出资人民币130万元。基于谨慎性原则，发行人已将前述合计5,130.00万元投资认定为本次发行相关董事会决议日前六个月至今新增的财务性投资。经发行人第一届董事会第二十二次会议审议，前述财务性投资金额5,130.00万元已从本次募集资金总额中扣除。截至2023年末和2024年3月末，公司认缴的晶汇聚芯出资额5,000.00万元已全部实缴，认缴的晶合汇信出资额130.00万元尚未实缴；截至本募集说明书摘要签署日，前述认缴的晶合汇信出资额130.00

万元已全部实缴。

#### 4、可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关报表项目情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关报表项目情况如下：

单位：万元

序号	科目	截至 2024 年 3 月 31 日账面价值
1	交易性金融资产	2,002.15
2	其他应收款	49.29
3	其他流动资产	7,738.10
4	一年内到期的非流动资产	1,053.89
5	其他非流动金融资产	5,000.00
6	其他非流动资产	25,316.33

##### （1）交易性金融资产

截至 2024 年 3 月末，公司交易性金融资产账面价值为 2,002.15 万元，均系公司购买的本金保障型金融产品，具体情况参见本节之“八、财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资”之“（2）2024 年 3 月末”之序号 1 的金融产品。相关金融产品主要投资范围为银行存款和衍生金融工具，衍生金融工具包括但不限于商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。截至 2024 年 3 月末发行人持有的金融产品均为挂钩利率、商品价格等金融市场指标的产品，风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，因此不属于财务性投资。

##### （2）其他应收款

截至 2024 年 3 月末，公司其他应收款具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	是否属于财务性投资	说明
押金保证金	100.19	否	生产经营相关
减：坏账准备	50.90	/	/
合计	49.29	/	/

截至 2024 年 3 月末，公司其他应收款账面价值为 49.29 万元，主要系押金

保证金等，不属于财务性投资。

### (3) 其他流动资产

截至 2024 年 3 月末，公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	是否属于财务性投资	说明
待抵扣进项税额	7,560.26	否	生产经营相关
预付可转债中介费用	142.92	否	本次发行相关
待摊租赁费	34.92	否	生产经营相关
合计	<b>7,738.10</b>	/	/

截至 2024 年 3 月末，公司其他流动资产账面价值为 7,738.10 万元，主要系待抵扣进项税额、预付可转债中介费用和待摊租赁费等，不属于财务性投资。

### (4) 一年内到期的非流动资产

截至 2024 年 3 月末，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 1,053.89 万元，系公司购买的将于一年内到期的可转让大额存单，具体情况参见本节之“八、财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资”之“（2）2024 年 3 月末”之序号 2 的金融产品，风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，因此不属于财务性投资。

### (5) 其他非流动金融资产

2024 年 3 月末，公司其他非流动金融资产为 5,000.00 万元，系公司参与设立产业基金晶汇聚芯形成的权益性投资。截至 2024 年 3 月末，公司认缴的晶汇聚芯出资额 5,000.00 万元已全部实缴，认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元尚未实缴；截至本募集说明书摘要签署日，前述认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元已全部实缴。前述合计 5,130.00 万元投资属于财务性投资。

### (6) 其他非流动资产

截至 2024 年 3 月末，公司其他非流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	是否属于财务性投资	说明
----	----	-----------	----

大额存单	12,553.16	否	金融产品，风险性较小
预付设备工程款	12,655.54	否	生产经营相关
预付软件款	107.63	否	生产经营相关
合计	25,316.33	/	/

截至 2024 年 3 月末，公司其他非流动资产账面价值为 25,316.33 万元，主要系大额存单、预付设备工程款和预付软件款等。其中，预付设备工程款和预付软件款均为生产经营相关，不属于财务性投资；大额存单的具体情况参见本节之“八、财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资”之“（2）2024 年 3 月末”之序号 3-6 的金融产品，风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，因此不属于财务性投资。

## 九、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
营业收入	123,829.30	100.00%	93,965.28	100.00%	79,569.99	100.00%
营业成本	91,077.63	73.55%	66,978.21	71.28%	56,001.84	70.38%
营业利润	19,841.15	16.02%	16,924.14	18.01%	13,612.63	17.11%
利润总额	19,558.29	15.79%	17,389.70	18.51%	14,031.82	17.63%
净利润	19,598.50	15.83%	17,722.50	18.86%	14,031.82	17.63%

### （一）营业收入分析

#### 1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	116,845.37	94.36%	88,438.82	94.12%	76,593.90	96.26%
其他业务收入	6,983.94	5.64%	5,526.46	5.88%	2,976.09	3.74%

合计	123,829.30	100.00%	93,965.28	100.00%	79,569.99	100.00%
----	------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

公司主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务。报告期内，公司主营业务收入分别为 76,593.90 万元、88,438.82 万元和 116,845.37 万元，占营业收入的比例均在 90%以上，主营业务突出。公司其他业务收入主要系出售含金废液等所产生的收入，占营业收入的比例较低。

报告期内，公司主营业务收入持续增长，主要原因如下：

### **(1) 境内显示面板的高速发展及显示驱动芯片产业向境内的转移推动公司收入增长**

随着国家产业政策的扶持鼓励以及终端应用领域的需求提升，境内显示面板行业实现了高速发展。受益于此，境内显示驱动芯片及其封装测试需求相应增长。

此外，显示驱动芯片的引脚众多且排列紧密，对封装测试的技术要求也更高，金凸块制造技术实现了“以点代线”的技术跨越，可以显著提高产品性能。公司是中国境内较早具备金凸块制造能力并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，拥有合肥与扬州两座封测基地，随着全球显示驱动芯片产业逐渐向境内转移，公司报告期内的收入增长迅速。

### **(2) 公司 12 吋封装测试服务持续扩产迎合客户需求，订单快速增长**

报告期内，公司 12 吋封装测试服务持续扩产，收入增长迅速。由于 12 吋晶圆较 8 吋晶圆具备更高的经济效益，下游客户对 12 吋晶圆的的需求快速增长，但其对生产工艺、产品良率管理的要求也更高。公司凭借稳定可控的 12 吋晶圆加工良率与优质的服务能力，12 吋晶圆封测服务订单快速增长。

### **(3) 集成电路产业集聚优势带来公司收入规模攀升**

报告期内，合肥封测基地凭借集成电路产业集聚优势，收入规模攀升。一方面，合肥封测基地与部分客户所合作的晶圆制造商同位于合肥产业集聚群，对显示驱动芯片设计公司而言，封测厂商靠近晶圆制造厂可以缩短晶圆从制造厂到封装测试厂的交付周期、降低生产运输成本；另一方面，公司可以提供 12 吋晶圆的封测全制程统包服务，能提高封装测试环节的生产效率，缩短交付周期。

## 2、主营业务收入产品构成及分析

报告期内，公司主营业务收入均来自于对显示驱动芯片的封装测试，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
显示驱动芯片	116,845.37	100.00%	88,438.82	100.00%	76,593.90	100.00%
合计	<b>116,845.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,438.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,593.90</b>	<b>100.00%</b>

公司对客供晶圆在完成客户约定的工艺制程并交付后确认收入。其中，主营业务收入若按工艺制程划分，可分属于金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装。公司的四个工艺制程实质上是四项独立的业务，公司根据四个制程进行独立核算。报告期内，公司主营业务收入按工艺制程划分的具体情况如下：

单位：万元

工艺制程	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	53,459.55	45.75%	41,032.11	46.40%	33,138.84	43.27%
CP	31,452.66	26.92%	25,095.22	28.38%	19,690.71	25.71%
COG	14,861.05	12.72%	11,333.52	12.82%	9,295.91	12.14%
COF	17,072.11	14.61%	10,977.97	12.41%	14,468.45	18.89%
合计	<b>116,845.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,438.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,593.90</b>	<b>100.00%</b>

公司以提供显示驱动芯片的全制程统包服务为目标。报告期内，公司围绕核心工序金凸块制造形成了完整的封装测试体系，带动公司主营业务收入持续增长。

## 3、主营业务收入按照销售区域划分

报告期内，公司主营业务收入的地区构成情况如下：

单位：万元

区域	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	44,432.24	38.03%	31,871.18	36.04%	18,750.60	24.48%
华东地区	17,991.78	15.40%	10,061.88	11.38%	11,887.41	15.52%
华南地区	14,586.47	12.48%	13,866.58	15.68%	6,466.87	8.44%

其他地区	11,853.98	10.15%	7,942.72	8.98%	396.33	0.52%
<b>境外</b>	<b>72,413.13</b>	<b>61.97%</b>	<b>56,567.64</b>	<b>63.96%</b>	<b>57,843.30</b>	<b>75.52%</b>
中国台湾	70,615.76	60.44%	52,994.11	59.92%	52,703.36	68.81%
中国香港	1,797.36	1.54%	3,573.53	4.04%	5,139.94	6.71%
<b>合计</b>	<b>116,845.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,438.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,593.90</b>	<b>100.00%</b>

注：境内外划分以直接交易客户注册地址的境内外归属作为标准。

报告期内，公司主要客户大多为中国台湾地区的知名显示驱动芯片设计公司，境外客户实现主营业务收入分别为 57,843.30 万元、56,567.64 万元和 72,413.13 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 75.52%、63.96%和 61.97%；2022 年起，公司境外客户收入占比有所下降，主要系公司报告期内天德钰、爱协生、集创北方等中国大陆地区客户需求增加，销售规模持续增长。

#### 4、主营业务收入季节性波动情况

报告期内，公司主营业务收入按季度划分如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	23,197.66	19.85%	22,179.02	25.08%	15,202.50	19.85%
第二季度	28,884.92	24.72%	21,430.53	24.23%	19,785.31	25.83%
第三季度	32,074.32	27.45%	23,286.31	26.33%	20,649.64	26.96%
第四季度	32,688.47	27.98%	21,542.96	24.36%	20,956.45	27.36%
<b>合计</b>	<b>116,845.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,438.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,593.90</b>	<b>100.00%</b>

2021 年度和 2023 年度，公司收入存在季节性变动，第三、四季度收入占比高，主要系受终端行业需求和生产周期的影响。一方面，公司所封装测试的显示驱动芯片主要应用于日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品，上述终端产品的需求旺季集中在第四季度与次年的第一季度；另一方面，受春节假期等因素影响，显示驱动设计公司一般会安排在第三、四季度提前备货生产以保证供应稳定，相应带动显示驱动芯片的封装测试需求。2022 年度，公司第四季度收入占比较低，主要系 2022 年下半年至 2023 年一季度，受全球经济下行影响，智能手机、高清电视等终端应用市场消费需求有所下滑所致。

## （二）营业成本分析

### 1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	85,101.81	93.44%	61,743.70	92.18%	53,131.91	94.88%
其他业务成本	5,975.82	6.56%	5,234.51	7.82%	2,869.93	5.12%
合计	<b>91,077.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>66,978.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,001.84</b>	<b>100.00%</b>

注：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履行直接相关的运费与保险费计入成本，报表列示为营业成本，本节营业成本分析均包含运费与保险费。

报告期内，公司主营业务成本分别为 53,131.91 万元、61,743.70 万元和 85,101.81 万元，占营业成本的比例均在 90%以上，与主营业务收入结构匹配。

### 2、主营业务成本产品构成及分析

报告期内，公司主营业务成本均为显示驱动芯片封装测试的成本，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
显示驱动芯片	85,101.81	100.00%	61,743.70	100.00%	53,131.91	100.00%
合计	<b>85,101.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,743.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,131.91</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本按工艺制程划分情况如下：

单位：万元

工艺制程	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	40,867.25	48.02%	30,146.08	48.82%	27,149.95	51.10%
CP	20,786.51	24.43%	14,095.45	22.83%	10,512.03	19.78%
COG	11,921.94	14.01%	8,591.49	13.91%	6,542.25	12.31%
COF	11,526.11	13.54%	8,910.68	14.43%	8,927.69	16.80%
合计	<b>85,101.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,743.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,131.91</b>	<b>100.00%</b>



报告期内，随着公司业务规模持续增长，各工艺制程的成本整体呈上涨趋势。报告期内，金凸块制造成本占比分别为 51.10%、48.82%和 48.02%，占比较高，主要系金凸块制造工序主要原材料为含金原料，含金原料价值较高导致直接材料成本较高。

### 3、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	38,269.33	44.97%	26,958.12	43.66%	25,052.10	47.15%
直接人工	11,430.82	13.43%	8,227.16	13.32%	7,220.44	13.59%
制造费用	34,355.78	40.37%	25,730.49	41.67%	19,930.07	37.51%
运费保险费	1,045.87	1.23%	827.93	1.34%	929.30	1.75%
合计	<b>85,101.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,743.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,131.91</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和运费保险费构成，其中直接材料和制造费用占主营业务成本的比例合计超过 80%，是最主要的构成部分。

报告期内，公司直接材料成本分别为 25,052.10 万元、26,958.12 万元和 38,269.33 万元。公司的直接材料成本主要来自于金凸块制造环节，直接材料主要包括含金原料（含金电镀液、金盐和金靶等）、Tray 盘和光刻胶等。直接材料占主营业务成本比例高，主要系金凸块制造使用的含金原料价值较高所致。

报告期内，公司直接人工分别为 7,220.44 万元、8,227.16 万元和 11,430.82 万元。报告期内，随着公司业务规模增长，公司为满足生产需求招聘生产人员，直接人工金额持续增长。

报告期内，公司制造费用分别为 19,930.07 万元、25,730.49 万元和 34,355.78 万元。报告期内，公司制造费用金额持续增长，主要系公司为扩充产能，持续购置生产设备，折旧规模不断增加所致。

报告期内，公司运费保险费分别为 929.30 万元、827.93 万元和 1,045.87 万元，2022 年运费保险费金额有所下降主要系公司运输至境内的产品占比提升所

致，2023 年运费保险费金额随公司业务规模扩张有所增加。

### （三）毛利及毛利率分析

#### 1、毛利构成及毛利率情况

报告期内，公司毛利构成及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
主营业务毛利	31,743.56	27.17%	26,695.12	30.18%	23,462.00	30.63%
其他业务毛利	1,008.12	14.43%	291.96	5.28%	106.16	3.57%
合计	<b>32,751.68</b>	<b>26.45%</b>	<b>26,987.07</b>	<b>28.72%</b>	<b>23,568.16</b>	<b>29.62%</b>

报告期内，公司毛利分别为 23,568.16 万元、26,987.07 万元和 32,751.68 万元，综合毛利率分别为 29.62%、28.72%和 26.45%；其中主营业务毛利分别为 23,462.00 万元、26,695.12 万元和 31,743.56 万元，主营业务毛利率分别为 30.63%、30.18%和 27.17%。

2021 年和 2022 年，公司主营业务毛利率保持较高水平，主要系公司整体产能利用率较高，规模效应导致单位固定成本较低，带动公司主营业务毛利率保持较高水平。2023 年度，公司主营业务毛利率较 2021 年和 2022 年有所下降，主要系 2022 年下半年至 2023 年第一季度，公司产品终端应用市场消费需求有所下滑，销售单价有所降低，而订单饱和度有所下降，单位固定成本有所上升导致；2023 年第二季度起，显示面板市场需求有所回暖，销售单价和订单饱和度情况均已有所好转。

#### 2、主营业务毛利构成及毛利率变化情况

报告期内，公司主营业务毛利均来源于显示驱动芯片封装测试业务，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
显示驱动芯片	31,743.56	27.17%	26,695.12	30.18%	23,462.00	30.63%

合计	31,743.56	27.17%	26,695.12	30.18%	23,462.00	30.63%
----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

报告期内，公司主营业务毛利和毛利率按工艺制程划分情况如下：

单位：万元

工艺制程	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
Gold Bumping	12,592.31	23.55%	10,886.03	26.53%	5,988.89	18.07%
CP	10,666.15	33.91%	10,999.77	43.83%	9,178.69	46.61%
COG	2,939.11	19.78%	2,742.03	24.19%	2,753.66	29.62%
COF	5,545.99	32.49%	2,067.29	18.83%	5,540.76	38.30%
合计	31,743.56	27.17%	26,695.12	30.18%	23,462.00	30.63%

### (1) 金凸块制造

2021 年至 2022 年，公司金凸块制造业务毛利率有所上升，主要系：一方面，公司 12 吋晶圆金凸块制造业务产能持续扩充，整体产能利用率较高，产销量增长形成的规模效应带动单位固定成本降低，公司高附加值的 12 吋晶圆金凸块制造业务占比有所上升，带动金凸块制造业务毛利率整体有所上升；另一方面，公司生产人员整体熟练度提高，公司对人员结构进行优化，单位人工成本有所降低。

2023 年，公司金凸块制造业务毛利率较 2022 年有所下降，主要系 2023 年度受终端应用市场消费需求下降及黄金价格市场价格有所上涨影响，导致金凸块制造业务单位成本上涨幅度高于销售单价上涨幅度。

### (2) 晶圆测试

2021 年和 2022 年，公司晶圆测试业务毛利率保持较高水平，主要系：一方面，2021 年和 2022 年客户对封装测试服务需求量较高，同时公司高阶智能手机测试业务占比相对提高，导致公司对主要客户的服务单价有所提高；另一方面，公司的晶圆测试产量较高，规模效应导致 12 吋晶圆测试的单位固定成本较低，公司高附加值的 12 吋晶圆金凸块制造业务占比保持较高水平。

2023 年，公司晶圆测试业务毛利率较 2022 年有所下滑，主要系：公司 2022 年四季度至 2023 年一季度受终端需求波动影响，晶圆测试业务销售单价有所降低；此外，公司晶圆测试业务规模效应有所减弱，导致单位固定成本增加，2023 年二季度起，显示面板市场需求有所回暖，晶圆测试业务毛利率有所回升。

### （3）玻璃覆晶封装

2022 年，公司玻璃覆晶封装毛利率较 2021 年度小幅降低，主要系 2022 年四季度起，公司玻璃覆晶封装业务量受终端需求影响有所减少，单位固定成本增加导致毛利率降低；2023 年，同样受终端市场消费需求影响，公司玻璃覆晶封装单位固定成本保持较高水平，导致 2023 年玻璃覆晶封装业务毛利率较低。

### （4）薄膜覆晶封装

2022 年，受大尺寸显示面板市场景气度波动的影响，公司薄膜覆晶封装业务产销量有所下滑，单位固定成本和单位直接人工成本增加，导致毛利率水平较低。

2023 年，随着大尺寸显示面板市场需求有所回暖，公司薄膜覆晶封装业务产销量有所提升，单位固定成本和单位直接人工成本大幅降低，推动毛利率水平较 2022 年度增长。

## 3、与可比公司毛利率的比较情况

### （1）同行业可比公司的选择依据、选取范围及合理性

公司考虑了行业属性、封测产品种类、技术路径、经营规模、财务数据可比性等因素，基于全面性和可比性原则，选取了集成电路封装测试行业的国内 A 股上市公司顾中科技、通富微电、晶方科技、利扬芯片和气派科技以及境外上市公司顾邦科技和南茂科技作为同行业可比公司。

#### ①顾中科技

顾中科技系专业从事集成电路高端先进封装测试的科创板上市公司，产品覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品，2023 年度主营业务收入为 15.93 亿元。顾中科技业务以显示驱动芯片封测为主，因此公司将其纳入可比范围。

#### ②通富微电

通富微电专业从事集成电路封装测试，在行业内具备知名度，2023 年度其集成电路封装测试业务收入达到 211.35 亿元。同时，目前 A 股上市公司中通富微电已布局显示驱动芯片金凸块制造业务，因此公司将其纳入可比范围。

### ③晶方科技

晶方科技专业从事晶圆级芯片封装测试，2023 年度主营业务收入为 9.13 亿元，与公司同属高端先进封装领域，均具备 8 吋与 12 吋晶圆的封装测试能力，因此公司将其纳入可比范围。

### ④利扬芯片

利扬芯片系专业从事晶圆测试与芯片测试服务的科创板上市公司，能同时提供 8 吋晶圆与 12 吋晶圆的测试服务，2023 年度的主营业务收入为 4.85 亿元。公司同样具备 8 吋与 12 吋晶圆的测试能力，因此公司将其纳入可比范围。

### ⑤气派科技

气派科技系专业从事集成电路的封装、测试业务的科创板上市公司，其业务范围中亦提供部分显示驱动芯片的封装测试服务，2023 年度的主营业务收入为 5.21 亿元，整体业务规模与公司接近，因此公司将其纳入可比范围。

### ⑥颀邦科技

颀邦科技为中国台湾上市公司，系全球领先的显示驱动芯片封测厂商，2023 年度的营业收入为 2,005,638.80 万新台币，主要从事凸块制造以及后段封装测试业务，封测产品涵盖显示驱动芯片、功率放大器、射频驱动芯片等半导体元件。其显示驱动芯片封测业务中的金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装与公司业务类似，因此公司将其纳入可比范围。

### ⑦南茂科技

南茂科技为中国台湾上市公司，系全球领先的显示驱动芯片封测厂商，2023 年度的营业收入为 2,135,622.80 万新台币。主要从事凸块制造以及后段封装测试业务，封测产品涵盖显示驱动芯片、记忆体芯片和逻辑芯片等半导体元件。其显示驱动芯片封测业务中的金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装与公司业务类似，因此公司将其纳入可比范围。

## (2) 同行业可比公司的毛利率数据比较

报告期内，公司与同行业可比公司的毛利率比较情况如下：

公司名称	主营业务	2023 年度	2022 年度	2021 年度
颀中科技	显示驱动芯片封装测试	36.04%	39.71%	40.76%
通富微电	集成电路封装测试	11.50%	13.58%	16.97%
晶方科技	集成电路封装测试	38.12%	44.11%	52.45%
利扬芯片	集成电路测试	29.93%	37.59%	53.00%
气派科技	集成电路封装测试	-16.94%	1.04%	30.47%
平均值（中国大陆可比公司）		<b>19.73%</b>	<b>27.21%</b>	<b>38.73%</b>
颀邦科技	显示驱动芯片封装测试	25.56%	32.63%	32.32%
南茂科技	显示驱动芯片封装测试	16.62%	20.89%	26.47%
平均值（中国台湾可比公司）		<b>21.09%</b>	<b>26.76%</b>	<b>29.40%</b>
发行人	显示驱动芯片封装测试	<b>27.17%</b>	<b>30.18%</b>	<b>30.63%</b>
其中：Gold Bumping		23.55%	26.53%	18.07%
CP		33.91%	43.83%	46.61%
COG		19.78%	24.19%	29.62%
COF		32.49%	18.83%	38.30%

注 1：数据来源于同行业可比公司公开披露数据；

注 2：上表中中国台湾可比公司数据系综合毛利率。

中国大陆同行业可比公司中，公司与通富微电、晶方科技、利扬芯片和气派科技等毛利率存在一定差异，主要系上述同行业可比公司的业务类型与公司的主营业务不完全一致：通富微电除先进封装业务还有较大规模的传统封装业务；晶方科技主要从事 CMOS 影像传感器的封装测试服务；利扬芯片主营晶圆测试与芯片测试服务，不涉及封装业务；气派科技主营业务中传统封装占比较高。

颀中科技专业从事集成电路高端先进封装测试，产品以显示驱动芯片封测为主，与公司具备一定的可比性。报告期内，公司毛利率变化趋势与颀中科技相似，但略低于颀中科技，主要系：一方面，公司高阶产品产能相对较少，且产品结构中毛利率较高的薄膜覆晶封装业务占比较低；另一方面，公司整体业务规模相对颀中科技较小，规模效应相对较弱导致单位成本较高所致。

2021 年，公司毛利率低于中国大陆同行业可比公司平均水平，主要系公司金凸块制造工艺制程占公司主营业务收入比重较高，但其直接材料主要为含金原料，材料成本占比较高，导致该工艺制程毛利率相对较低，从而拉低了公司整体毛利率。2022 年和 2023 年度，公司毛利率水平高于中国大陆同行业可比公司平均水平，主要系气派科技主营业务中传统封装占比较高，受手机、计算机等终端

应用市场需求波动影响较大，叠加其自身募投项目和自有资金扩产等因素，毛利率水平大幅降低所致。

中国台湾的颀邦科技和南茂科技均为全球领先的封测厂商，业务涵盖凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装等显示驱动芯片封测服务，与公司具备一定的可比性。报告期内，公司毛利率水平与中国台湾同行业可比公司相近，略高于中国台湾同行业可比公司平均水平，主要系显示驱动芯片封测产业呈现向中国大陆转移的趋势，中国台湾同行业可比公司规模效应有所减弱所致。

#### （四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	840.96	0.68%	904.06	0.96%	549.42	0.69%
管理费用	6,666.60	5.38%	5,216.50	5.55%	4,055.28	5.10%
研发费用	7,885.72	6.37%	6,514.01	6.93%	6,060.30	7.62%
财务费用	-600.12	-0.48%	-160.36	-0.17%	277.62	0.35%
合计	<b>14,793.16</b>	<b>11.95%</b>	<b>12,474.21</b>	<b>13.28%</b>	<b>10,942.62</b>	<b>13.75%</b>

报告期内，公司期间费用合计分别为 10,942.62 万元、12,474.21 万元和 14,793.16 万元，占营业收入的比例分别为 13.75%、13.28%和 11.95%。报告期内，随着公司业务规模扩大，期间费用支出逐年有所增长。

##### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	423.41	50.35%	510.15	56.43%	344.26	62.66%
股份支付	238.16	28.32%	252.86	27.97%	139.79	25.44%
业务招待费	98.88	11.76%	75.94	8.40%	43.42	7.90%
办公差旅费	59.61	7.09%	27.48	3.04%	18.67	3.40%

其他费用	20.90	2.49%	37.64	4.16%	3.29	0.60%
<b>合计</b>	<b>840.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>904.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>549.42</b>	<b>100.00%</b>

公司销售费用主要由职工薪酬、股份支付、业务招待费等组成。报告期内，随着公司业务规模扩大，公司业务招待费以及办公差旅费等费用逐年增加。2023年，公司销售人员职工薪酬有所降低，主要系2022年度公司向销售人员发放的奖金金额较大所致。公司于2019年、2020年和2023年分别对核心员工进行了股权激励，报告期内确认的股份支付费用计入销售费用的金额分别为139.79万元、252.86万元和238.16万元。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬及补偿款	2,279.62	34.19%	1,940.22	37.19%	1,596.54	39.37%
折旧摊销费	794.01	11.91%	876.88	16.81%	761.58	18.78%
股份支付	1,606.63	24.10%	404.87	7.76%	321.33	7.92%
中介机构费	633.64	9.50%	823.38	15.78%	336.71	8.30%
物业服务费	154.06	2.31%	129.62	2.48%	113.66	2.80%
办公差旅费	610.96	9.16%	330.18	6.33%	286.43	7.06%
其中：保险费-财产险	150.38	2.26%	-	-	-	-
业务招待费	261.35	3.92%	400.55	7.68%	281.82	6.95%
环安费、维修费	268.17	4.02%	213.77	4.10%	293.69	7.24%
其他费用	58.17	0.87%	97.03	1.86%	63.52	1.57%
<b>合计</b>	<b>6,666.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,216.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,055.28</b>	<b>100.00%</b>

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销费、股份支付、中介机构费、办公差旅费、业务招待费以及环安费、维修费等组成。报告期内，随着公司生产经营规模持续扩大，公司各类管理费用整体呈增长趋势。2022年度管理费用较2021年度有所增长，主要原因是：1) 2022年度公司规模有所增长，公司基于经营需求招聘了一定数量的管理人员，管理人员数量有所增加，管理人员职工薪酬费用有所增长；2) 公司于2022年完成首次公开发行工作，相关中介机构费用和业务



招待费用有所增长；2023 年度管理费用较 2022 年度有所增长，主要系 2023 年度公司通过限制性股票方式对核心员工实施股权激励，导致股份支付金额较大所致。

### 3、研发费用

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工费用	3,135.34	39.76%	2,960.98	45.46%	2,420.07	39.93%
折旧费用	2,232.37	28.31%	1,992.48	30.59%	2,009.09	33.15%
直接投入费用	1,213.05	15.38%	907.60	13.93%	1,084.16	17.89%
股份支付	977.85	12.40%	411.52	6.32%	320.31	5.29%
其他费用	327.12	4.15%	241.42	3.71%	226.67	3.74%
<b>合计</b>	<b>7,885.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,514.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,060.30</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司研发费用分别为 6,060.30 万元、6,514.01 万元和 7,885.72 万元，占营业收入的比例分别为 7.62%、6.93%和 6.37%。报告期内，公司高度重视技术研发投入和产品应用开发，持续开展高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片、图像处理芯片等领域的研发项目，研发费用金额逐年增长。公司持续加大研发技术人员储备，并于 2019 年、2020 年和 2023 年对核心人员进行股权激励，研发费用中人工薪酬和股份支付费用金额逐年增长。

### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息支出	-0.48	-0.00%	873.63	0.93%	27.17	0.03%
其中：租赁利息支出	19.62	0.02%	17.71	0.02%	-	-
减：利息收入	210.23	0.17%	223.42	0.24%	83.97	0.11%
银行手续费	22.36	0.02%	24.11	0.03%	22.21	0.03%
汇兑损益	-411.77	-0.33%	-680.49	-0.72%	70.20	0.09%

融资担保手续费	-	-	-154.18	-0.16%	242.00	0.30%
合计	<b>-600.12</b>	<b>-0.48%</b>	<b>-160.36</b>	<b>-0.17%</b>	<b>277.62</b>	<b>0.35%</b>

报告期内，公司财务费用分别为 277.62 万元、-160.36 万元和-600.12 万元。2022 年，公司使用首次公开发行募集的补流资金归还了全部银行借款，且受人民币汇率波动影响，汇兑损益金额变动较大，导致 2022 年财务费用为负；2023 年，公司收到财政贴息 110.22 万元冲减财务费用，且受人民币汇率波动影响，汇兑损益金额变动较大，导致 2023 年利息支出和财务费用为负。

## （五）其他损益项目分析

### 1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加分别为 228.55 万元、436.08 万元和 444.67 万元。2022 年和 2023 年，公司税金及附加金额有所增长，主要系公司所缴纳的房产税和印花税有所增加。

### 2、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
与资产相关的政府补助	1,721.07	1,608.42	1,564.66
与收益相关的政府补助	475.31	453.09	332.47
其他	5.75	4.00	12.08
合计	<b>2,202.13</b>	<b>2,065.51</b>	<b>1,909.22</b>

报告期内，公司其他收益分别为 1,909.22 万元、2,065.51 万元和 2,202.13 万元，主要为政府补助。

### 3、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为-5.74 万元、266.47 万元和 1,021.27 万元。2022 年和 2023 年，公司投资收益金额较大，主要系公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品所获取的收益。

#### 4、公允价值变动损益

2022年和2023年，公司公允价值变动损益分别为144.17万元和424.28万元，系公司持有的交易性金融资产所致。

#### 5、信用减值损失/资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失、资产减值损失明细情况如下：

单位：万元

项目	类型	2023年度	2022年度	2021年度
信用减值损失	坏账损失	-639.70	338.79	-111.38
资产减值损失	存货跌价损失	-1,015.75	-1,440.82	-907.42
合计		<b>-1,655.44</b>	<b>-1,102.03</b>	<b>-1,018.80</b>

报告期内，公司信用减值损失分别为-111.38万元、338.79万元和-639.70万元，均为坏账损失。公司根据企业会计准则的相关规定，将应收账款、其他应收款等项目的坏账准备计入信用减值损失；存货跌价损失分别为-907.42万元、-1,440.82万元和-1,015.75万元，随着公司存货规模持续增长，公司报告期各期存在一定存货跌价损失。

#### 6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为330.96万元、1,473.23万元和335.06万元，主要系报告期内公司对部分专用设备等固定资产进行处置产生的收益。

#### 7、所得税费用

2022年和2023年，公司所得税费用分别为-332.80万元和-40.21万元，系递延所得税费用。报告期内，公司所得税费用金额较少，主要系：一方面，报告期初期公司累计未弥补亏损金额较大；另一方面，公司享受高新技术企业购置设备器具加速折旧以及研发费用加计扣除政策所致。

#### 8、营业外收支

报告期内，公司营业外收支明细情况如下：

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
政府补助	37.00	464.00	399.00

无需支付款项	0.84	0.23	0.50
其他	46.79	71.81	23.66
<b>营业外收入合计</b>	<b>84.63</b>	<b>536.04</b>	<b>423.16</b>
非流动资产处置损失	73.09	68.62	-
对外捐赠	-	-	3.98
其他	294.40	1.86	0.00
<b>营业外支出合计</b>	<b>367.49</b>	<b>70.48</b>	<b>3.98</b>

报告期内，公司营业外收入分别为 423.16 万元、536.04 万元和 84.63 万元。2021 年和 2022 年，公司营业外收入金额较大，主要系收到的企业上市奖励款，属于与公司日常活动无关的政府补助，故计入营业外收入。报告期内，公司营业外支出分别为 3.98 万元、70.48 万元和 367.49 万元，2023 年度，营业外支出金额较大，主要系公司向少数客户支付了赔偿款所致。

#### （六）存在累计未弥补亏损的影响

报告期内，公司营业收入、息税折旧摊销前利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和累计未分配利润/未弥补亏损如下：

单位：万元

项目	2023 年度/ 2023.12.31	2022 年度/ 2022.12.31	2021 年度/ 2021.12.31
营业收入	123,829.30	93,965.28	79,569.99
息税折旧摊销前利润	47,730.24	39,909.84	31,195.48
净利润	19,598.50	17,722.50	14,031.82
扣除非经常性损益后的净利润	16,819.47	12,618.17	9,393.19
累计未分配利润/未弥补亏损	11,028.50	-6,465.26	-22,400.72

截至 2023 年末，公司累计未分配利润为 11,028.50 万元，公司累计未弥补亏损情况已消除。

#### 1、报告期内存在未弥补亏损的原因

公司报告期内存在未弥补亏损主要系前期亏损较多所致，主要原因如下：

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，通常需要

经历相对较长的达产期。因此，在达产期前期，长期资产折旧与摊销等固定成本较高，收入规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，导致公司早期形成的累计未弥补亏损金额较大。

母公司股改后，其账面累计未弥补亏损已消除。截至最近一期末，公司累计未弥补亏损情况已消除。

## 2、累计未弥补亏损的影响分析

随着显示面板下游市场需求的增加和公司生产工艺的优化、产能的持续释放，公司技术水平和产品质量得到市场认可，收入规模快速增长，经营状况持续向好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 29,539.89 万元、60,114.17 万元和 35,145.96 万元，公司经营状况整体良好；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 9,393.19 万元、12,618.17 万元和 16,819.47 万元，报告期内公司均实现盈利。

报告期内，公司的经营规模和营业收入均实现了快速增长，在销售业绩及各渠道融资的支持下，公司在报告期内各经营环节运作良好，截至最近一期末，公司累计未弥补亏损情况已消除。公司报告期内存在累计未弥补亏损的情形不会对公司的现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、经营可持续性等方面产生重大不利影响。

## 十、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	35,145.96	60,114.17	29,539.89
投资活动产生的现金流量净额	-55,008.35	-137,744.76	-38,591.39
筹资活动产生的现金流量净额	17,899.60	85,593.52	8,998.22
汇率变动对现金的影响	49.23	329.00	-262.34
现金及现金等价物净增加额	-1,913.56	8,291.93	-315.61
现金及现金等价物余额	10,963.87	12,877.43	4,585.50

**（一）经营活动产生的现金流量分析**

报告期内，公司经营活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	111,966.09	111,654.87	78,935.26
收到的税费返还	6,108.08	11,689.65	1,769.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,200.74	4,625.64	4,105.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>119,274.91</b>	<b>127,970.16</b>	<b>84,810.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	64,268.61	50,764.99	41,362.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,437.69	13,535.38	11,567.06
支付的各项税费	460.19	498.92	269.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,962.45	3,056.70	2,071.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>84,128.95</b>	<b>67,855.99</b>	<b>55,270.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,145.96</b>	<b>60,114.17</b>	<b>29,539.89</b>

报告期内，随着公司经营规模逐年扩大，经营活动产生的现金流量持续净流入，经营活动现金净流量情况良好。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较大，主要系预收部分主要客户货款金额较大及收到大额存量留抵税额返还所致。

**（二）投资活动产生的现金流量分析**

报告期内，公司投资活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
收回投资收到的现金	169,800.00	83,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,221.39	200.52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589.42	2,316.31	1,041.36
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>171,610.81</b>	<b>85,516.83</b>	<b>1,041.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,819.17	58,261.58	39,632.75
投资支付的现金	107,800.00	165,000.00	-

投资活动现金流出小计	226,619.17	223,261.58	39,632.75
投资活动产生的现金流量净额	-55,008.35	-137,744.76	-38,591.39

报告期内，公司持续扩充产能，购置先进专用设备，导致投资活动现金净流出金额较大。2021 年度、2022 年度以及 2023 年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 39,632.75 万元、58,261.58 万元和 118,819.17 万元。2022 年和 2023 年，公司收回投资收到的现金和投资支付的现金金额较大，主要系公司为提高资金使用效率，对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，购买和赎回理财产品所致。

### （三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
吸收投资收到的现金	-	135,142.95	9,995.28
取得借款收到的现金	18,542.33	38,349.92	52,998.77
收到其他与筹资活动有关的现金	-	250.00	3,085.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,542.33</b>	<b>173,742.87</b>	<b>66,079.05</b>
偿还债务支付的现金	-	82,763.98	46,920.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73.10	1,534.70	1,756.66
支付其他与筹资活动有关的现金	569.63	3,850.68	8,404.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>642.73</b>	<b>88,149.35</b>	<b>57,080.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,899.60</b>	<b>85,593.52</b>	<b>8,998.22</b>

2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额处于较低水平，主要系公司当年度股权融资金额较少并且归还了部分银行借款所致；公司归还了转贷借款以及通过短期借款置换长期借款以降低借款利率，导致当期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金发生额较大。

2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年度大幅增长，主要系公司首次公开发行募集资金到账所致；公司使用募集的补流资金偿还了全部银行借款，导致当期偿还债务支付的现金发生额较大。

2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额和发生额较少，主要系公司

已于 2022 年度归还了以前年度全部银行借款，且 2023 年度新增银行借款金额较少且无其他融资事项所致。

## 十一、资本性支出分析

### （一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司实际支付的资本性支出分别为 39,632.75 万元、58,261.58 万元和 118,819.17 万元。

公司属于先进封装测试服务商，集成电路封装测试行业对生产设备有较高要求，因此公司的生产设备投入规模大、占资产比重高。报告期内，公司的资本性支出主要用于购置先进的生产设备，用以扩充产能。

### （二）公司已公布或可预见将实施的重大资本性支出情况

截至本募集说明书摘要签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目和汇成二期项目第一阶段的投资支出。

公司本次募集资金投资项目支出内容、支出目的及资金需求的解决方式参见本募集说明书摘要“第五节 本次募集资金运用”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”的相关内容。

2023 年 9 月，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议的议案》，汇成二期项目第一阶段预计总投资 100,000.00 万元。

### （三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

公司资本性支出不涉及跨行业投资。

公司主要从事显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务，是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。

公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，致力于先进封装技术的研究与应用，深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业中具有领先地位。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精



度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目、本次募集资金投资项目和“新建车载显示芯片项目”为公司主营业务及延伸的相关产品的产能扩张项目和研发中心建设项目，是科技创新的实施项目。

## 十二、技术创新分析

### （一）技术先进性及具体表现

公司始终将技术创新作为价值创造的源动力，在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺。公司的技术先进性及具体表现参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、与产品有关的技术情况”。

### （二）正在从事的研发项目及进展情况

公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术、产品创新作为核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。

截至 2023 年末，公司正在研发的主要项目如下表所示：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
1	先进封装领域高晶圆吸附可靠性的结构及工艺研发	导入量产	提升台盘吸附性与对晶圆的保护作用，避免等待时间过长导致晶圆被刮伤、污染	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
2	高阶影像封装技术研发	项目结案	掌握高阶影像传感器封测技术，成功批量封测高阶影响类产品	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
3	先进晶圆测试设备自动除尘降温机构设计	导入量产	通过设置洁净装置，达到测试环境优化，提高良率	显示驱动芯片等领域
4	先进领域封装一种金凸块空洞检测方式	导入量产	通过研究新空洞检测工序技术，提高效率，新产品研发中的空洞可靠度流程大幅缩短，缩短研发时间	显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
5	超高硬度金凸块工艺研发	导入量产	通过调整添加剂的比重与成分，通过生产过程中的优化调整，提金凸块的硬度，提高良率	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
6	先进封装领域一种双面散热贴附工艺研发	申请专利并导入量产	双面散热贴附机构设计,提高散热效果增加产品良率	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
7	一种载盘固定校正机构设计	导入量产	降低翻盘次数,提升固定杆稳定性.提升晶粒转置良率	高阶显示驱动芯片、CMOS 影像传感器芯片和新能源车载芯片等领域
8	一种高温测试环境的快速降温设计	申请专利	提升测试环境温度稳定性,能快速达到降温目的	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
9	高深宽比线路金凸块生长工艺的研发	工艺设计与开发	解决了现有金凸块制造工艺中高深宽比线路区产生空洞无法填充完整的问题	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
10	高解析密集驱动封装技术研发	产品验证	高密度金凸块生产工艺技术,越高的驱动芯片控制与分辨率能力考验生产稳定度,稳定生产良率	显示驱动芯片等领域
11	先进封装领域一种黏轮机构工艺研发	申请专利并导入量产	导入黏轮机构至生产工艺内,降低particle影响并提升产品良率	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
12	凹型金凸块工艺研发	工艺设计与开发	提升ACF中导电粒子捕获数	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
13	先进封装领域一种测试分类机传送机构工艺研发	工艺设计与开发	通过设计新式传送机构,提升产品传送稳定度及品质,使产品大幅降低芯片崩缺/隐裂风险及强化抗静电能力	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
14	提高驱动芯片封装压合效果工艺的研发	导入量产	改善驱动芯片封装压合效果	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
15	显示驱动芯片捡晶技术改善与品质安全防呆技术及装置的研发	导入量产	确保机械手臂移动稳定性,避免晶粒表面受力不均	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
16	久储晶圆凸块再生工艺研发	导入量产	降低芯片封装及封装成本	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
17	柔性基板封装工艺散热技术的研发与应用	导入量产	解决柔性基板封装IC散热难题	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
18	多段式光阻去除工艺的研发	小批量生产	降低产品异常发生率,提高产品品质及良率	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
19	柔性基板(FILM)双芯封装技术的研发与应用	小批量生产	提升芯片集成度,扩展芯片功能及品质稳定性	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
20	一种减少负胶蚀刻气泡异常的结构及工艺研发	工艺设计与开发	减少蚀刻药液气泡产生,提升蚀刻效果,降低蚀刻异常发生率,提升产品品质及良率	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
21	显示驱动封装磨划技术工艺的研发与应用	小批量生产	解决产品破损问题,提升产品可靠性与良率	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域

### **（三）保持持续技术创新的机制和安排**

公司自成立以来，高度重视技术创新工作，经过多年的实践与积累，已建立了一套以自身研发实力为基础、以客户市场需求为导向、以高端人才为核心的技术创新机制，为公司的技术进步和工艺水平提升提供了制度保障。公司保持持续技术创新的机制和安排具体参见募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”之“（二）公司保持科技创新能力的机制或措施”。

## **十三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响**

经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《合肥新汇成微电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以股本总数 834,853,281 股为基数，扣减回购专用证券账户中的股数 10,447,004 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），上述利润分配预案已经 2023 年年度股东大会批准，并已于 2024 年 6 月 6 日发放。

除上述事项外，截至本募集说明书摘要签署日，公司不存在重大对外担保、诉讼、或有事项或其他重大期后事项。

## **十四、本次发行的影响**

### **（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划**

本次发行完成后，公司将获得长期发展资金，且随着未来可转换公司债券持有人陆续转股，公司债务结构将更加合理。如未来实际经营需要，公司将合理制定资产整合计划，并积极履行信息披露义务。

### **（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化**

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充。未来随着募集资金投资建设项目的实施，将进一步提升公司的生产能力；补充流动资金将提升公司营运资金规模、缓解流动资金压力，为提高经营业绩及盈利能力提供充足的资金保障。综上，募投项目的实施，将有利于提升公司各项业务竞争力，并为公司业务升级打下坚实基础。

### **（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况**

本次发行完成后，公司的实际控制人仍为郑瑞俊和杨会，公司控制权不会发生变化。

## 第五节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金使用计划

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含 114,870.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	47,611.57	35,000.00
2	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	56,099.47	50,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	29,870.00
	合计	<b>138,711.04</b>	<b>114,870.00</b>

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

### 二、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目

##### 1、项目概况

本项目的实施主体为合肥新汇成微电子股份有限公司，项目建设地点为合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号，项目总投资 47,611.57 万元，计划建设期为 36 个月。本项目利用现有厂房进行建设，开展新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试生产。本项目建成后，将有效提升公司的生产能力和产能规模，

为公司未来业务发展提供可靠的扩产基础，进一步巩固公司行业地位，提高市场份额。

## 2、与现有业务的关系

公司目前聚焦于显示驱动芯片的封装测试，以金凸块制造（Gold Bumping）为核心，综合晶圆测试（CP）及玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），具备显示驱动芯片全制程的先进封装测试综合服务能力。本项目拟在现有业务的基础上，结合当前 OLED 等新型显示驱动芯片市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备和软件，开展新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试服务。本项目建成后，将有效提升公司 OLED 等新型显示驱动芯片的封测服务规模，为公司未来业务发展提供可靠的扩产基础，巩固公司在显示驱动芯片封测领域的领先地位，提高市场份额。

## 3、项目实施的必要性

### （1）本项目有利于满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求

公司是国内领先的显示驱动芯片封装测试服务商，制程包括金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装。公司多次开展生产线投资扩产，目前已建成江苏扬州和安徽合肥两大生产基地，由于技术稳定且服务完善，在全球范围内取得了广泛认可。

在市场需求方面，近年来 OLED 显示屏市场渗透率快速提升，根据 Frost & Sullivan 数据，2020 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达到 14.0 亿颗，预计 2025 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达 24.5 亿颗，市场占比达到 10.5%。针对市场发展趋势，公司计划扩大在 OLED 领域的产能配置，但是公司当前的设备配置无法满足 OLED 显示驱动芯片需求快速增长的生产需要。为抓住市场机遇，公司计划引进先进高效的生产设备，提升 OLED 产品封装测试能力，满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求，进一步提升公司在显示驱动芯片领域的竞争优势。

### （2）本项目有利于满足市场对先进封装测试服务的需要

随着技术的升级换代，高集成度、低能耗成为电子产品最主要的发展趋势，终端用户对性能体验的要求促进了芯片设计、制造与封装的发展。先进封装测试

工艺能够减小芯片占用尺寸、布线长度、厚度等，帮助降低能耗，提高终端用户的屏幕交互体验，促使显示面板厂商会优先采用先进封装测试工艺，因此市场规模快速增长。公司自主开发的金凸块制造技术直接在晶圆上形成焊球或金柱，在此基础上实现了显示驱动芯片的晶圆级高密度细间距倒装封装，有助于开发屏占比高和轻薄化的显示面板，符合整体行业发展趋势。本项目引入先进高效的生产设备后能够提高公司针对 OLED 等新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造和测试服务能力，满足下游客户不断增长的对先进显示驱动芯片封装测试的需求。

### （3）本项目有利于提升公司的品牌影响力

随着我国集成电路产业供应链体系的不断完善，本土显示驱动芯片产业的发展前景广阔。首先，第三代显示技术 OLED 具有能耗低、发光率好、亮度高和轻薄等优点，在终端设备中的应用越来越广泛，国产厂商的产能规模快速扩大。其次，随着智能网联汽车的兴起，座舱系统对显示面板的需求快速增加，有望拉动显示面板行业的增长。本项目建成后，公司将扩大 OLED 面板的显示驱动封装测试规模，并且拓展车载显示面板市场，扩大国内市场份额，提升公司的品牌影响力。

## 4、项目实施的可行性

### （1）公司具备先进且成熟的制程工艺

公司长期专注于显示驱动芯片封装测试的研究开发和产业化应用，针对显示驱动芯片封装测试过程中的具体工艺或生产装置进行技术研发，自主研发积累了大量工艺技术，在行业内具有领先地位。公司的核心技术包括驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术、高精度高效内引脚接合工艺等，特别是金凸块制造技术以黄金作为材料，具有出色的导电性、机械加工性以及散热性能，可满足显示面板驱动的使用要求。本项目各制程主要采用公司成熟的工艺，可快速部署投入生产，保障项目顺利实施。

### （2）公司具备扎实的客户合作基础

集成电路设计与制造行业具有技术和资本密集特点，行业集中度较高。基于对产品良率和成本的考量，封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺

认证后才能达成长期合作，故存在较高的供应链门槛。公司凭借稳定的产品良率、全流程的生产服务能力和交付能力获得了行业内知名客户的广泛认可。公司的下游客户覆盖了全球排名前五和国内排名前十显示驱动芯片设计公司中的主要企业，包括联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等知名显示驱动芯片设计企业，具备良好的客户合作基础，能够为本项目的投产运营提供市场支持。

### （3）公司具备良好的产业政策和区位优势

公司地处长三角地区，整体经济较为发达，具备产业人才和科研力量集聚优势，并且得到国家和地方的政策扶持，因此该地区也成为我国集成电路发展最快的区域。安徽省及合肥市均出台了集成电路产业相关政策，例如《安徽省“十四五”科技创新规划》等，鼓励先进封装测试技术的研发和产线投资建设，为企业发展提供了良好条件。

本项目实施地点位于合肥市新站区综合保税区内，在长三角区域经济一体化的辐射范围内。新站区以新型显示、集成电路、高端装备制造、新能源汽车为四大主导产业，集聚了京东方、维信诺、晶合集成等面板产业链企业，显示面板产线规模为国内领先，并以产业分类排名第一获评国家级新型显示产业集群。公司立足合肥市，面向长三角地区，具备与产业链上下游沟通合作的便利条件，有利于节约成本和提升运营效率，为项目建设实施提供便利条件。

## 5、项目实施和投资概算

### （1）项目实施主体及地址

本项目实施主体为汇成股份，建设地点位于合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号，保税区及周边交通顺畅，厂区内公辅配套设施完善，可充分满足项目需求。

### （2）项目实施时间及进展

本项目实施期为36个月，厂房内部装修预计在建设期第一年内完成，主要生产设备将分批次下单采购、安装和调试，依次投入试生产和运营，以保证项目尽快取得经济效益。具体进度如下表所示：



序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	装修施工	*											
2	设备采购	*	*			*	*			*			
3	设备安装调试		*	*			*			*	*		
4	人员招聘与培训			*	*		*	*			*		
5	项目试运行					*	*	*	*	*	*	*	*

### (3) 项目投资概算

本项目计划投资总额为 47,611.57 万元，总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，其中建设投资 44,171.33 万元，铺底流动资金 3,440.24 万元。本项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>44,171.33</b>	<b>35,000.00</b>
1.1	建筑工程费（装修）	290.50	200.00
1.2	设备及软件购置费	42,181.11	34,200.00
1.3	安装工程费	783.62	600.00
1.4	工程建设其他费用	50.00	-
1.5	预备费	866.10	-
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>3,440.24</b>	<b>-</b>
	<b>合计</b>	<b>47,611.57</b>	<b>35,000.00</b>

## 6、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

### (1) 营业收入预计

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出。本项目建成后，预计在正常年可实现营业收入为 30,269.04 万元（不含税），年利润总额为 6,021.05 万元，项目投资财务内部收益率为 12.98%（所得税后），投资回收期为 7.88 年（所得税后，含建设期 3 年）。

### (2) 营业成本和费用测算

本次募投项目的产品成本主要包括原辅材料、直接人工、燃料动力和制造费

用。原辅材料参考目前各产品材料成本计算；直接人工根据项目新增生产人员和工程人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算；燃料动力包含水、电、天然气和液氮；制造费用包含折旧、摊销、修理费和其他制造费用。

期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。销售费用按照公司销售费用占收入比例的历史水平进行测算。管理费用中人工费用根据项目新增管理人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算，折旧摊销费用根据项目投资对应折旧摊销金额进行测算，其余管理费用参照汇成股份管理费用占收入比例的历史水平进行测算。研发费用参照汇成股份研发费用占收入比例的历史水平进行测算。财务费用按照本次可转债预计发生的利息费用进行测算。

### **(3) 所得税测算**

增值税按照 13% 测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；企业所得税率按 15% 测算。

## **7、项目的立项、土地、环保等有关报批事项**

本项目在合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号现有厂房进行建设，公司已取得本项目建设地所属地块的不动产权证书。本项目已完成项目备案手续（项目备案号：2306-340163-04-05-470278），已取得环评批复（环建审（2023）12038 号）。

## **(二) 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目**

### **1、项目概况**

本项目的实施主体为公司的全资子公司江苏汇成光电有限公司，项目建设地点为江苏省扬州市高新区金荣路 19 号，项目总投资 56,099.47 万元，计划建设期为 36 个月。本项目利用现有厂房进行扩产建设，拟在现有业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备，扩大新型显示驱动芯片晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）的生产规模。本项目建成后，将有效提高公司生产能力，满足下游市场需求，扩大公司在行业的影响力，提高盈利能力。

## 2、与现有业务的关系

公司是一家专业从事显示驱动芯片封装测试的企业，为客户提供芯片封测服务。根据行业发展趋势和公司战略发展，公司拟建设本次“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”，由全资子公司江苏汇成光电有限公司建设实施。本项目拟在现有业务的基础上，结合当前 OLED 等新型显示驱动芯片市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备，扩大晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装的生产规模。本项目建成后，将有效提高公司 OLED 等新型显示驱动芯片的封装测试能力，满足下游市场需求，扩大公司在行业的影响力，提高盈利能力。

## 3、项目实施的必要性

### （1）顺应行业发展趋势，满足市场需求

随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势，消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于 OLED 显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。显示驱动芯片作为 OLED 屏的上游产业，晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨。公司作为专业从事于晶圆测试和封装的企业，在显示驱动芯片封测行业深耕多年，具备丰富的产品经验和服务技术经验。本项目主要面向逐步扩大的 OLED 面板市场，提前进行产能规划，提升晶圆测试服务的规模，提高覆晶封装产线的服务能力，有利于发挥公司行业竞争优势，满足公司发展需求，同时有利于满足 OLED 显示驱动芯片市场需求，促进显示驱动芯片行业高质量发展。

### （2）有利于提高规模效益，抢占市场份额

显示驱动芯片封装测试行业技术水平要求较高、资金需求大、人才综合素质门槛高、客户认证严格，因此行业进入壁垒较高，国内可以实现大规模显示驱动芯片封装测试的企业较少。公司在显示驱动芯片封装测试领域从业多年，拥有扎实的核心技术体系和规模生产经验，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。通过本项目的建设，公司的封装测试服务能力进一步加强，扩充了产品生产规模，强化了规模效益，有利于降低服务成本，提高单位产品的盈利能力；另一方面，本项目购置的先进封测设备，能够满

足新型 OLED 产品的生产需求，从而公司能够更快地布局 OLED 显示驱动芯片封测市场，抓住 OLED 市场机遇。有助于公司稳固现有客户的同时，进行 OLED 市场的开拓，获取更大的市场份额。

### （3）有利于提高封装测试行业的国产化水平

目前，我国的液晶显示面板产能占到了全球的 60%以上，但我国芯片产业起步较晚，境外发达国家及地区已经掌握芯片制程的核心技术，并占据了主要芯片市场，因此显示面板上游的芯片制造等高附加值产业大多为境外企业所掌握。在此背景下，境内企业拓展显示面板产品上游产业链，提升产业链上游及中游产品供给能力，实现全流程国产化势在必行。本项目的建设，有助于推动芯片产业链中芯片封测这一环节的建设，强化国产芯片在晶圆封测这一环节的技术能力，使境内产业链整体流转更加畅通，提高行业的国产化水平。

## 4、项目实施的可行性

### （1）广阔的市场前景为项目的实施提供了保障

随着社会经济和科学技术的发展，显示驱动产品不仅仅应用于智能手机、电脑、电视等电子产品，智能家居的兴起使得智能冰箱、空调、家居中控也都采用显示屏作为智能交互系统。同时，由于新能源汽车的智能驾驶、智慧座舱理念的推广，车载用屏尺寸和数量持续上升，车载显示市场需求快速增长。根据 Frost & Sullivan 分析，由于晶圆产能供给紧张，显示驱动芯片的产量不足，将持续推高销售价格，因此显示驱动芯片封测市场规模也将随之上涨，预计在 2025 年达到 56.10 亿美元。在显示驱动芯片封测市场需求量持续走高的情况下，下游市场能够快速消化本项目新增的产能，为本项目的运营提供保障。

### （2）夯实的技术基础为项目建设提供了保障

显示驱动芯片封装测试行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，需要企业具备丰富的生产加工经验。近年来，OLED 显示驱动芯片不断应用于高端电子消费产品和新能源汽车上，下游厂商对于 OLED 显示驱动芯片的品质要求越来越高，且集成电路设计和制造业技术不断进步，加快了各种封装技术和工艺水平的更新进步周期，需要企业不断进行创新和改进技术水平。公司具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力，在核心技术上，公司拥有驱动芯片可靠性工艺、微间

距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术、高精度高效内引脚接合工艺等。此外，公司技术团队从事显示驱动芯片封测行业多年，具备丰厚的技术经验，能够满足设计公司的目标和下游客户的需求。因此，公司具备扎实的行业经验，为本项目的实施提供支撑。

### （3）广泛的客户资源为项目建设提供了良好基础

由于芯片制造对技术、质量和成本有严格的把控要求，显示驱动芯片封测企业与客户建立合作需要进行层层严格认证。公司成立至今，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了众多优质客户，且产生了客户黏性，客户对公司认可度高，合作稳定。公司在长期的市场开拓过程中，已获得众多全球知名显示驱动芯片设计企业的认可，所封测的显示驱动芯片也被应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，服务能力被各方合作企业所信赖。综上所述，广泛的客户资源和良好的客户认可度，为公司的业务承接和业务推广提供了帮助，有助于本项目建成后的产能消化。

## 5、项目实施和投资概算

### （1）项目实施主体及地址

本项目由公司的全资子公司江苏汇成建设实施，建设地点位于江苏省扬州市高新区金荣路 19 号，将利用现有的厂房进行项目扩产建设。

### （2）项目实施时间及进展

本项目实施期为 36 个月，厂房内部装修预计在建设期第一年内完成，主要生产设备将分批次下单采购、安装和调试，依次投入试生产和运营，以保证项目尽快取得经济效益。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	装修施工	*											
2	设备采购	*	*			*	*			*			
3	设备安装调试		*	*			*			*	*		
4	人员招聘与培训			*	*		*	*			*		
5	项目试运行					*	*	*	*	*	*	*	*

### (3) 项目投资概算

本项目计划投资总额为 56,099.47 万元，总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，其中建设投资 54,806.42 万元，铺底流动资金 1,293.05 万元。本项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>54,806.42</b>	<b>50,000.00</b>
1.1	建筑工程费（装修）	1,885.10	1,500.00
1.2	设备及软件购置费	50,800.67	48,000.00
1.3	安装工程费	996.01	500.00
1.4	工程建设其他费用	50.00	-
1.5	预备费	1,074.64	-
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,293.05</b>	<b>-</b>
<b>合计</b>		<b>56,099.47</b>	<b>50,000.00</b>

## 6、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

### (1) 营业收入预计

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出。本项目建成后，预计在正常年可实现营业收入为 14,873.40 万元（不含税），年利润总额为 3,996.87 万元，项目投资财务内部收益率为 9.49%（所得税后），投资回收期为 8.64 年（所得税后，含建设期 3 年）。

### (2) 营业成本和费用测算

本次募投项目的产品成本主要包括原辅材料、直接人工、燃料动力和制造费用。原辅材料参考目前各产品材料成本计算；直接人工根据项目新增生产人员和工程人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算；燃料动力包含水、电、天然气和液氮；制造费用包含折旧、摊销、修理费和其他制造费用。

期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。销售费用按照公

司销售费用占收入比例的历史水平进行测算。管理费用中人工费用根据项目新增管理人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算，折旧摊销费用根据项目投资对应折旧摊销金额进行测算，其余管理费用参照江苏汇成管理费用占收入比例的历史水平进行测算。研发费用参照江苏汇成研发费用占收入比例的历史水平进行测算。财务费用按照本次可转债预计发生的利息费用进行测算。

### **(3) 所得税测算**

增值税按照 13% 测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2% 进行计提；企业所得税率按 15% 测算。

## **7、项目的立项、土地、环保等有关报批事项**

本项目在江苏省扬州市高新区金荣路 19 号现有厂房进行建设，公司已取得本项目建设地所属地块的国有土地使用证及房屋所有权证。本项目已取得扬州市邗江区工业和信息化局出具的《江苏省投资项目备案证》（扬邗工信备[2023]87 号），已取得环评批复（扬环审批〔2023〕05-51 号）。

## **(三) 补充流动资金**

### **1、项目概况**

为满足公司未来业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次可转换公司债券募集资金中的 29,870.00 万元用于补充流动资金。

### **2、补充流动资金的必要性**

#### **(1) 公司业务规模快速增长，营运资金需求逐步增加**

公司目前处于业务规模快速扩张时期，2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 79,569.99 万元、93,965.28 万元和 123,829.30 万元，年均复合增长率为 24.75%。随着公司业务规模的快速扩张，公司货币资金、应收账款、存货等流动资金需求逐步增加。因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券将为公司补充与业务规模相适应的流动资金，有效缓解公司的资金压力，为公司业务持续发展提供保障，实现公司长期持续稳定发展。

#### **(2) 持续增加的研发投入需要充足的流动资金作保障**

公司是国内领先的显示驱动芯片封装测试服务商，显示驱动芯片封装测试行业技术水平要求较高、资金需求大，公司需要不断进行研发创新、保持技术先进性。公司始终坚持技术研发在经营中的重要地位，将技术研发作为公司可持续经营的支柱，2021年、2022年和2023年，公司研发费用金额分别为6,060.30万元、6,514.01万元和7,885.72万元，始终保持较大研发投入，因此公司需要充足的流动资金以支持公司持续研发创新的需求。

### 3、补充流动资金的可行性

(1) 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

本次发行募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

(2) 公司内部治理规范，内控完善

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

## 三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

### (一) 本次募集资金投资属于科技创新领域

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目将用于“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”、“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”以及“补充流动资金”，系按照现有技术和客户基础、研发创新战略、业务发展规划等情况对现有先进封装业务进行的产能扩产和技术的延伸升级，有利于公司进一步提高先进封装测试领域的生产与研发实力，资金投向均围绕主营业务进行，投资于科技创新领域。



## **(二) 募投项目实施将促进公司科技创新水平提升**

“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”都是公司利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，前者将形成公司每年新增晶圆金凸块制造240,000.00片、晶圆测试54,000.00片的生产能力，后者将形成公司每年新增晶圆测试68,400.00片、玻璃覆晶封装20,400.00万颗、薄膜覆晶封装9,600.00万颗的生产能力，在保证产品良率的同时，提升产品技术水平和生产效率，巩固并提升公司的市场地位和综合竞争力，进一步提高相关产品的市场占有率。“补充流动资金项目”主要满足业务规模扩大带动的营运资金需求、研发投入的资金需求，将帮助公司夯实研发的软硬件基础，进一步提升研发实力。

## **四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性**

### **(一) 本次募投项目相关既有业务的发展概况**

本次募投项目募集资金系用于扩大公司显示驱动芯片封装测试业务的规模。在显示驱动芯片领域，公司具有领先的行业地位，是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入12吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力，具有较强的市场竞争力。同时，公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、奕力科技、集创北方等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。报告期各期内，公司在显示驱动芯片的先进封装测试领域营业收入分别为76,593.90万元、88,438.82万元和116,845.37万元，收入规模快速上升。

### **(二) 扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性**

#### **1、扩大业务规模的必要性**

公司扩大显示驱动芯片封测业务规模的必要性分析详见本节“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金

凸块制造与晶圆测试扩能项目”之“3、项目实施的必要性”和本节“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”之“3、项目实施的必要性”

## 2、新增产能规模的合理性

公司拟通过本次募投项目扩大显示驱动芯片封测业务产能，主要是基于旺盛的下游市场需求，具体来说：

### （1）中国大陆封装测试市场井喷式增长

随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，全球集成电路行业进入新一轮的上升周期，而受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，中国大陆封装测试市场跟随集成电路产业也实现了高速发展。近些年，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业，同时中国大陆芯片设计企业的规模也在逐步扩大，以及全球晶圆制造龙头企业也陆续在大陆建厂扩产，在此背景下，中国大陆封装测试企业将会步入更为快速的发展阶段。根据 Frost & Sullivan 数据，2016 年至 2020 年中国大陆封测市场的年复合增长率为 12.54%，远高于全球封测市场 3.89% 的增长速度，同时在未来中国大陆封测市场预计将继续保持高速增长，在 2025 年达到 3,551.90 亿元的市场规模。

### （2）OLED 显示驱动芯片快速增长

随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势，消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于 OLED 显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。显示驱动芯片作为 OLED 屏的上游产业，晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨。在市场需求方面，近年来 OLED 显示屏市场渗透率快速提升，根据 Frost & Sullivan 数据，2020 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达到 14.0 亿颗，预计 2025 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达 24.5 亿颗，市场占比达到 10.5%。

### （3）先进封装成为行业主流

随着集成电路器件性能的要求不断提高，促进了如 Bumping、Flip Chip、WLCSP、2.5D、3D 等先进封装技术的快速发展。后摩尔定律时代，由于先进制

程的研发投入及难度不断提升，制程技术不能带来成本的有效降低，集成电路行业将更多依靠先进封装技术来实现硬件上的突破。先进封装在提升芯片性能方面具有巨大优势，可以在不依赖先进制程工艺前提下，提高芯片整体性能以及集成度，从而满足终端设备对于芯片体积、性能等不断提升的需求。随着智能汽车、5G 手机等的先进封装需求增加，产能紧张，将会带动封测价格提升，国内提前布局先进封装业务的厂商将会受益。

综上所述，本次募投项目新增产能规模不仅充分考虑了下游需求规模及增速，也将下游客户新增产能对应的匹配需求纳入考量。因此，主动把握未来广阔的市场空间及发展机遇，扩大前瞻性布局，提前进行产能建设储备，以扩大先发优势，新增产能规模具有合理性。

## **五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次发行募集资金将用于 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，不会造成公司主营业务的重大变动。同时，上述项目投向科技创新领域，符合国家的相关产业政策和公司的整体战略发展方向，有利于公司巩固现有的竞争优势，具有良好的市场前景和经济效益。

本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司扩大市场份额，深化公司在相关板块的业务布局，有效提高公司的盈利能力及市场占有率。同时募投项目结合了市场需求和未来发展趋势，契合行业未来发展方向，有助于公司充分发挥规模优势，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升

公司的抗风险能力。

本次发行募集资金投资项目具有良好的经济效益，虽然短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到有效提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

## 第六节 备查文件

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- 二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书和律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级报告；
- 六、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之签章页）

合肥新汇成微电子股份有限公司

